



TOWA株式会社

〒601-8105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地
<https://www.towajapan.co.jp>

UD FONT
見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

TOWA株式会社

INTEGRATED REPORT 2025



統合報告書 2025



継承と革新で 新たなイノベーションカンパニーへ

1979年の創業から業界の常識にとらわれない斬新な技術を生み出し、
さまざまな課題と真剣に向き合ってきたTOWA。
培ってきた技術で未来を創造し、「変革で世界の頂」を目指します。

2022/4 ~ 2025/3
第一次中期経営計画

「世界の頂」への基盤強化

売上高実績 **534.7億円**

2025/4 ~ 2028/3
第二次中期経営計画

新たな課題への挑戦と飛躍

売上高目標 **710億円**

2028/4 ~ 2032/3
第三次中期経営計画

売上高1,000億円と
高利益率の達成

売上高目標 **1,000億円**

TOWAビジョン2032 変革で世界の頂へ

ありたい姿

- 1 パッケージングプロセス提案により顧客価値を創出し続ける世界のリーディングカンパニー
- 2 TOWAの技術でサステナブルな社会を実現する会社
- 3 積極的な情報発信で知名度の高い会社
- 4 企業文化の伝承と多様な価値観を尊重する笑顔で働ける会社

表紙のキャラクター紹介

トワッピー

「トワッピー」は、長期ビジョン「TOWA ビジョン2032」達成に向けたメッセージを広く内外に発信するため制作したキャラクターです。

プロフィールなど詳しくはP.50



Happy Tech Happy World

経営理念

産業社会が最も求める「技術開発」を根幹に、
クォーター・リードに徹した「新製品・新商品」の創成に向けて、
果敢なる挑戦のもと、全力を傾注して成果を生み出し、
もって産業の発展に多大の貢献をはたす。

経営の基本方針

TOWAグループは、超精密金型を創り出してきた「金型関連技術」が
当社のコア・コンピタンスであると考えております。

この原点に立ち戻って、コア・コンピタンスを活かした事業領域に経営資源を集中し、
QCD(Quality品質・Cost原価・Delivery納期)の最適化を図り、収益体質を確立してまいります。
また、「薄型化・微細化・多段化」をテーマに技術革新が続く半導体パッケージ技術の未来を見据え、
市場ニーズを先取りするソリューション提案型の開発・生産・販売戦略に取り組んでまいります。

CONTENTS

1 経営理念・経営の基本方針

プロフィール

- 3 目次・編集方針
- 5 At a glance
- 6 TOWAグループの事業内容
- 7 成長の軌跡

CHAPTER 01 マネジメントメッセージ

9 会長メッセージ



13 社長メッセージ

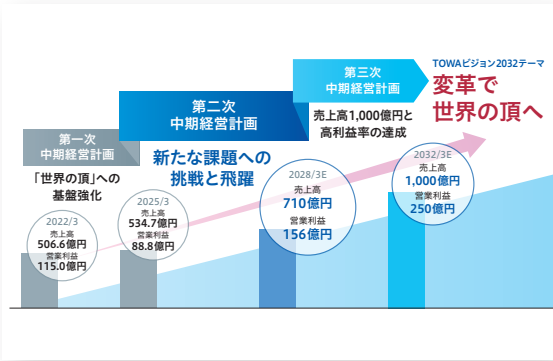


CHAPTER 02 価値創造ストーリー

- 17 TOWAグループの価値創造プロセス
- 19 TOWAグループの培った強み
- 21 TOWAグループの技術と製品

CHAPTER 03 価値創造の戦略

- 23 長期ビジョン「TOWAビジョン2032」
- 25 第一次中期経営計画の振り返り
- 27 第二次中期経営計画



- 29 事業戦略
- 31 財務戦略／キャッシュアロケーション
- 31 サステナビリティ戦略／マテリアリティ(重要課題)

33 特集 戦略的技術



- 35 半導体事業
- 37 新事業
- 38 メディカルデバイス事業
- 38 レーザ事業

CHAPTER 04 価値創造の基盤

39 TOWAグループのサステナビリティ



- 41 TOWAグループの環境への取り組み
- 45 TOWAグループの社会への取り組み
- 51 TOWAグループのコーポレートガバナンス
- 55 役員一覧

データセクション

- 57 財務・非財務ハイライト
- 59 財務情報
- 61 グローバルネットワーク
- 62 会社概要

編集方針

TOWAグループは、2022年度より財務活動と非財務活動を統合的に伝える報告書を発行しております。このたび発行いたしました「TOWA統合報告書2025」におきましては、当社グループの経営上のミッションである「技術水準向上へのあくなき追求」を目指す戦略ストーリーについて、当社グループのビジネスモデルとともに、ステークホルダーの皆様に分かりやすくご理解いただけるよう心掛けて編集いたしました。ステークホルダーの皆様との対話は、当社グループの持続的成長にとって必要不可欠であります。本報告書を通じて当社グループの取り組みをご覧いただき、忌憚のないご意見を賜れば幸いです。

報告対象期間

2024年度(2024年4月1日～2025年3月31日)を対象としていますが、それ以前、以後の情報も掲載しております。

報告対象範囲

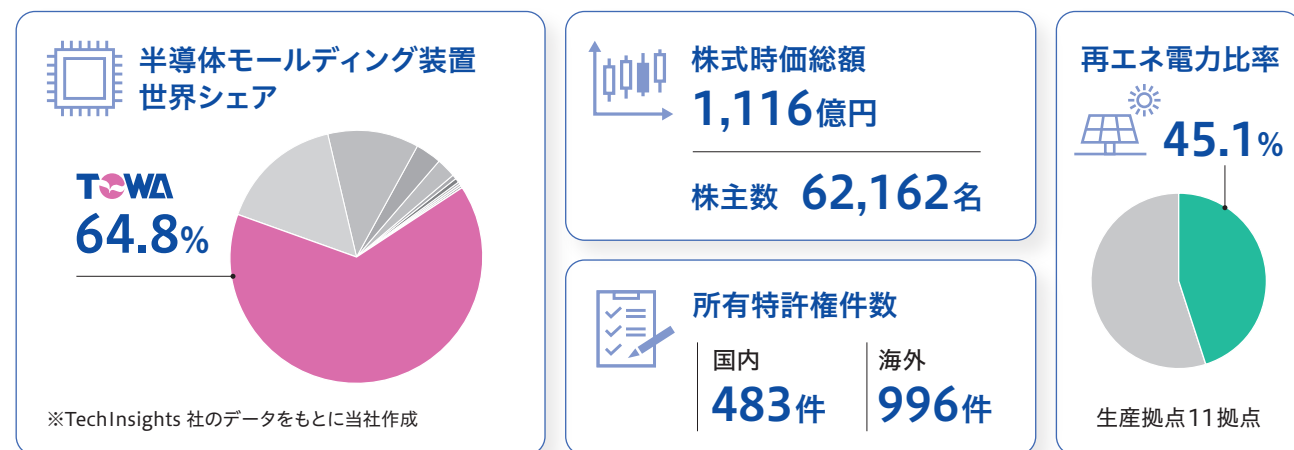
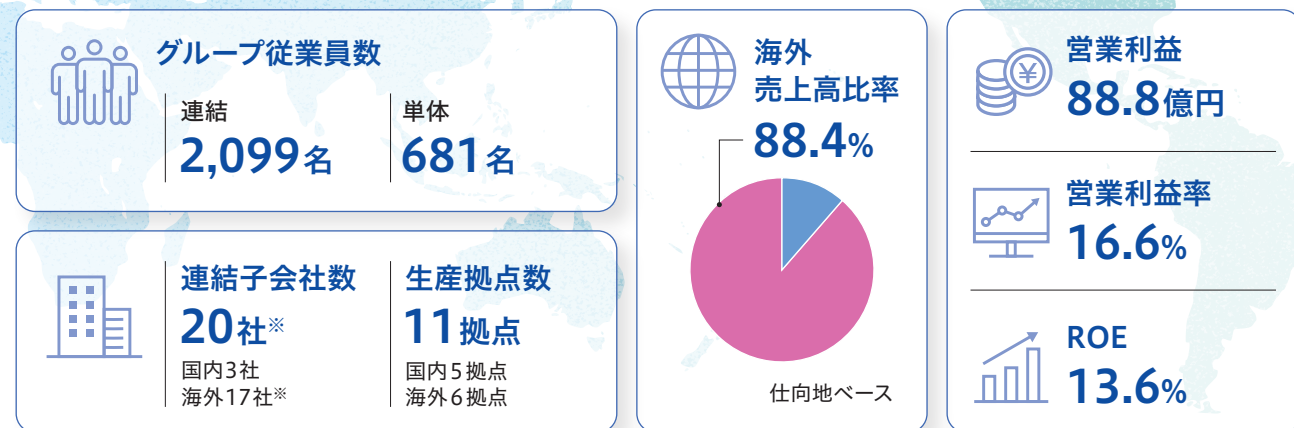
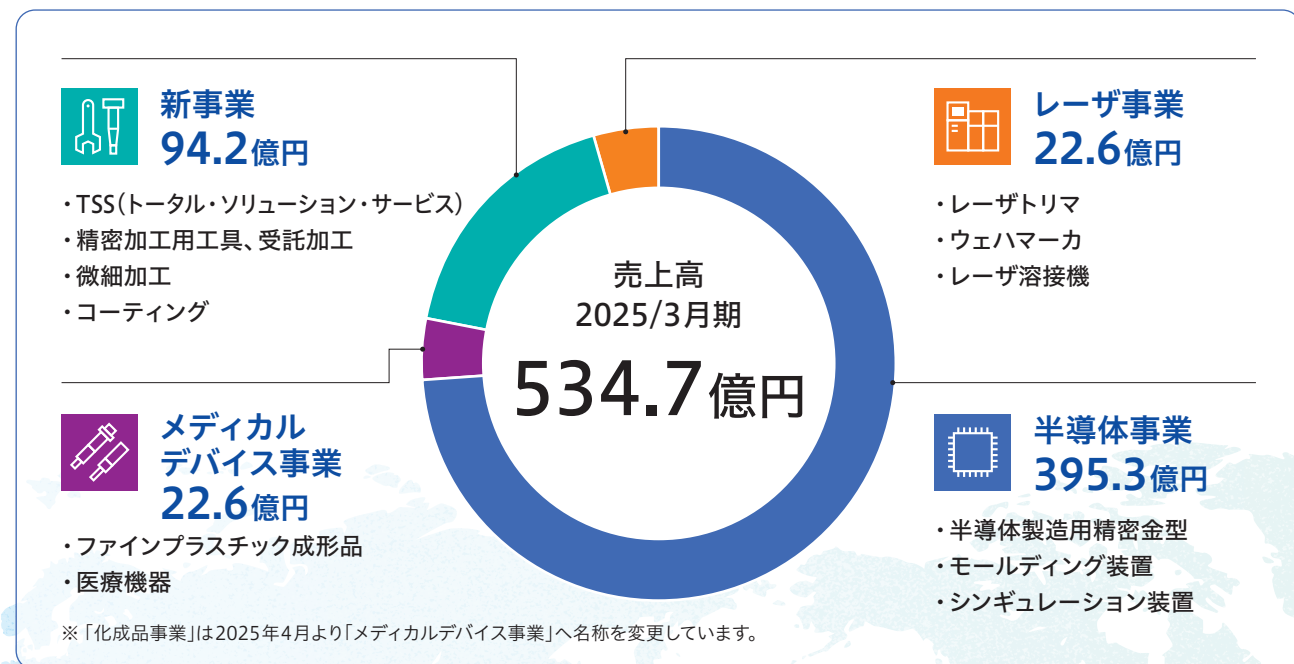
当社およびグループ会社

将来の見通しに関する注意事項

本報告書に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、作成時点で入手可能な情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、不確定な要素を含んでいます。実際の業績などはさまざまな要因により、見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知ください。

At a glance

創業以来、TOWAは技術開発型企業としてものづくりにおけるニーズを汲みとり、デファクトスタンダードを生み出してきました。現在、半導体事業を中心として、4つのセグメントを柱に、世界で事業を展開しています。



2025年3月期もしくは2025年3月末時点
※2025年4月末時点

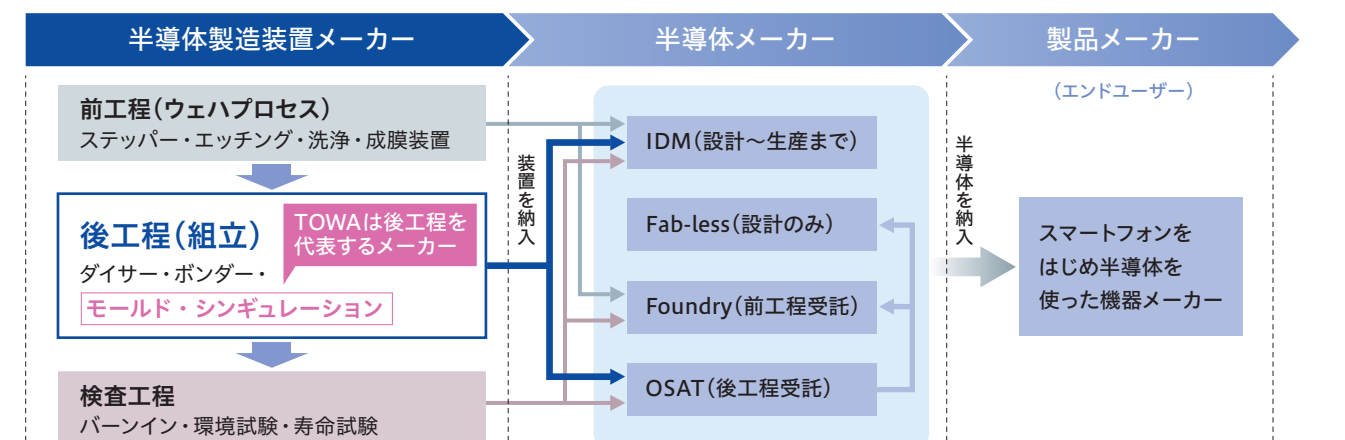
TOWAグループの事業内容

各セグメント事業の紹介



半導体製造におけるTOWAグループの立ち位置

半導体製造装置メーカーは、前工程・後工程・検査工程の各専用装置で住み分けされており、装置を半導体メーカーに納入します。半導体メーカーは装置メーカーの装置を使って半導体を製造し、半導体を使った製品をつくるメーカーに納入します。TOWAグループは後工程の半導体製造装置メーカーに属します。



成長の軌跡

TOWAは、勃興期の半導体産業と共に歩んできました。当社の歴史は技術革命の歴史であり、1979年の創業から、エポックメイキングな技術革命を通して成長を続けてまいりました。その端緒を開いたのがマルチプランジャの開発です。以来、常にこの業界で先陣を切って新技術、新製品を世に生み出し続けています。

1979

第1次モルディング革命

業界標準の確立

▶マルチプランジャの開発

技術革命 1 マルチプランジャモールドの登場

複数の小サイズ樹脂を注入する自動成形方式で、流路短縮により品質向上と廃棄樹脂低減を実現しました。

マルチプランジャ金型



1995

第2次モルディング革命

Yシリーズの爆発的ヒット

▶モジュールシステムの開発

技術革命 2 モジュールシステム(Yシリーズ)がベストセラーに

モジュール連結でプレスの増減が可能となり、それが後工程における時代のニーズに合致。自社のみならず半導体製造のデファクトスタンダードにして、業界の成長に貢献しました。



Yシリーズ

2009

第3次モルディング革命

新たな業界標準の確立

▶コンプレッション装置の市場投入

技術革命 3 コンプレッション成形方式で最先端製品に対応

TOWA独自のコンプレッション(圧縮)成形方式により、樹脂流動が無く最先端製品の成形を可能に。低コスト化、CO₂削減にも貢献します。



Model PMC1040-S

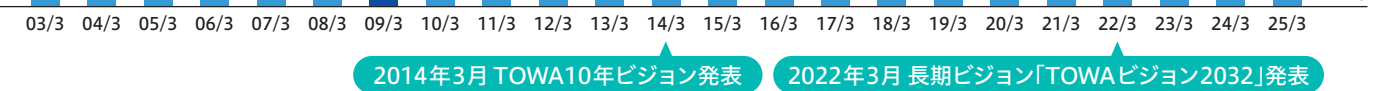
2032

変革で世界の頂へ

他社の追随を許さない
唯一無二の企業

1979 東和精密工業として創業

「超精密金型」および「半導体製造装置」の製造販売



主な出来事

1979年4月

東和精密工業として創業

●「超精密金型」および「半導体製造装置」の製造販売

1987年

医療分野に進出

●医療機器用の射出成形を開始

1991年

●株式会社バンディック(3月)、Micro Component Technology Malaysia Sdn. Bhd.(現TOWAM Sdn. Bhd.)(4月)を子会社化

1991年3月

●京都東事業所を新設

1996年

海外生産によるコスト低減

●海外生産拠点の本格的立上げ

1998年3月

●本社・工場が完成し移転

1998年12月

●九州工場(現九州事業所)を新設

2002年6月

●中国にTOWA半導体設備(蘇州)有限公司を設立

2004年

グローバル・サービス体制の確立

●海外各拠点でフィールドサービスを開始



2013年4月

●ソウルにTOWA韓国株式会社を設立

2015年10月

●TOWA韓国がSEMES Co.,Ltd.のモルディング事業を譲受

2015年

Samsung子会社のモールド事業をM&A

●Samsung第1ベンダーの地位を獲得

2018年8月

●オムロンレーザーフロント株式会社(現TOWAレーザーフロント株式会社)の株式を取得し子会社化

2018年10月

●中国南通に東和半導体設備(南通)有限公司を設立し、11月に精技電子(南通)有限公司の金型製造事業を譲受

2018年

レーザ加工装置事業をM&A 中国金型事業をM&A

2021年9月

●中国に東和半導体設備研究開発(蘇州)有限公司を設立

2022年 ブレード事業をM&A

●消耗品ビジネスの本格展開

2022年1月

●韓国のFine International Co., Ltd.(現TOWAファイン株式会社)の株式を取得し子会社化

2023年3月

●マレーシアにTOWA TOOL SDN. BHD. を設立し、4月にK-Tool Engineering Sdn. Bhd.の金型製造事業を譲受

会長 メッセージ



代表取締役会長
岡田 博和

挑戦する気概を次の世代に継承し、 TOWAの未来を切り拓いていきます。

【社長の交代にあたって】

10年ビジョンの達成を踏まえて、次世代へのバトンを三浦新社長に託す

2025年4月1日付で社長を交代し、新たに三浦宗男が社長に就任いたしました。これにともない、私、岡田博和は代表取締役会長（最高経営責任者）として新たな役割を担うこととなりました。新経営体制のもと、経営基盤の一層の強化および企業価値の向上を図ってまいります。

三浦新社長とは、私がシンガポールにて現地法人を立ち上げたときからの縁です。立ち上げメンバーの一人として10年以上の長期にわたって駐在し、技術面で相当に努力してくれました。その後、日本に戻ってから技術部門を経て、営業部門でもキャリアを積み、お客様との関係を構築してきました。語学に堪能で、お客様との会話がしっかりできる人財です。経営トップとしてまさに最適な存在だと思っています。

振り返りますと、私が社長に就任したのは2012年、61歳の時でした。当時の半導体産業はある年が好況で利益が出たとしても、次年はいきなり不況となって赤字に転じるといっ

た浮き沈みの激しい時代。変動の顕著な半導体サイクルを平準化し、持続的に成長できる企業を目指すことが、社長就任時の強い思いでした。社長就任に際して、創業者の坂東和彦から言われたことは、「お前との約束はただ一つ、絶対に赤字は出さな」でした。この強烈な一言は現在に至るまで一日たりとも忘れたことはありません。

幸い、コンプレッションモールドを筆頭に当社製品が業界をリードする存在となり、当社は成長軌道に乗って業績を向上させてきました。2014年当時、売上高は170億円程度、営業利益は数%がやっとという状況の中、私は「みんなで夢を見よう」と、10年後の2024年に売上高500億円、営業利益80億円（営業利益率16%）という高い目標を設定したのです。当初、社内からは「こんな数字、達成できるはずがない。社長、本気か？」といった声が上がったほどです。ところが、その後も「夢を見よう」と繰り返し言い続けていくうちに、従業員一

人ひとりが自ら目標に向けて取り組むようになりました。

以来、目標達成のために、市場の開拓や生産体制の整備、人財の育成に取り組んできた結果、売上高500億円の目標は2年前倒しの2022年3月期に達成しました。しかも、営業利益は目標だった80億円どころか、100億円を超え、営業利益率は22.7%に達しました。

本来、2024年を一つの区切りと考えていたのに対して、目標を2年早く到達したことで、次のビジョンを前倒しで描くことができました。2022年に長期ビジョン「TOWAビジョン2032」を策定し、2025年を「第一次中期経営計画」の最終年度と位置づけて取り組んできました。併行して、社長交代のタイミングを計ってきたわけです。この節目を逃すと、

次のタイミングは3年後になってしまいかねないと判断し、この度、社長を三浦宗男に託すことを決断しました。半導体業界の変化のスピードは目まぐるしく、世界を見渡すと40代～50代の経営者が目立ちます。当社として、よりスピード感のある経営を実現するため、若い世代へのバトンタッチが必要だと強く感じていました。こうした背景を踏まえ、今回の社長交代という決断に至った次第です。

半導体業界におけるTOWAの立ち位置が明確になっている現在、お客様の期待がますます高まっています。三浦を中心とした新体制に対しては、この流れを継承して事業運営を行うとともに、次の成長を見据えた展開を追求してほしいと願っています。

【社長時代の13年を振り返って】

果敢な海外投資で、TOWAの持続的成長を実現

社長時代の13年間を振り返ったとき、一番注力してきたのが海外市場への投資です。その原点は中国・蘇州での取り組みでした。2014年頃のこと、第2次安倍晋三内閣のいわゆるアベノミクスという経済政策の影響で為替の円安が一気に進み、日系メーカーの多くが中国から撤退していきました。そうした中で、当社は時流に逆行するかのように中国・蘇州工場の増築を決断したのです。当時、周辺の企業の方々からは「TOWAさんは、なぜこのタイミングで増築するのか」と驚かれたものです。

2016年に増築が完了し、2017年に操業を開始したところ、中国の半導体需要が再び伸び始めました。当社は生産能力を1.5倍に拡張していたことから、お客様のニーズを一気に取り込むことができました。今振り返ってみて、まさに最高のタイミングだったわけです。

では、なぜそのような判断ができたのか。その背景として、私自身が中国のお客様、特に経営トップの方々と定期的に対話を重ねていたことが挙げられます。何気ない会話の中に、決断を促すヒントがあり、「今こそ動くタイミングだ」と、直感したのです。

当時、現地のお客様との信頼関係を築く中で、大きな転換点を迎えていました。多くのメーカーが中国をコストセンターとして捉え、いかに安くモノをつくるかに奔走していました。しかし、私は中国が将来にわたってコストセンターであり続けるはずがないと考え、プロフィットセンターに変わるための体制づくりに着手したのです。現地の技術レベルを高め、生産ラインを自立的に構築できるようにする。そのためには、技術面でも組織面でも拠点ごとにしかりとした方向性を持たせることに尽力しました。

こうした取り組みを続けてきた中で、大きな手応えを感じたのが、2020年以降のコロナ禍です。それまで設備の据え付けなどは日本から人を派遣して対応していたのに対して、コロナ禍によってその手段が使えなくなりました。しかし、当社は現地のメンバーを育成していたことで、ローカルだけで完結できる体制ができあがっていたのです。これは本当に画期的な出来事であり、良いタイミングでローカライゼーションを実現することができました。

現在では、全ての海外拠点で事業運営のトップを現地のメンバーが担っています。中国の生産工場2か所、マレーシア、そして韓国。中国の開発拠点については日本人が関わっているものの、それ以外の生産拠点はすべて現地主導です。それぞれの拠点が自律的に運営できるようになったことで、TOWAグループ全体としてうまく機能していると判断しています。

当社はものづくり企業ですから、一番大切なのはお客様のニーズに沿った商品をつくって、きちんと収益を上げること。これに尽きます。そして、そのために最も重要なのが営業力です。いくら技術があっても、それをお客様のニーズに結びつけていく力がなければ意味がありません。だからこそ、営業担当がどれだけ最先端の情報を収集し、それを社内を持ち帰って方向性を示していけるか。これが今後の成長を左右します。

また、受注型メーカーとしてお客様のニーズに真に応えるためには、製品を納品した後のフォローが欠かせません。設備を納品し、据え付けて稼働させたら仕事は一応完結します。しかし、現地のお客様からは、それ以外の設備について「ここをちょっと見てほしい」「こうしてもらえないか」といった声が上がることがしばしばあります。一般的な対応として、

「それは自分の担当ではない」と断ることが多いかもしれませんが、しかし、当社の担当者はたとえ自分の担当外であってもご要望に応じようと努めます。分からない点は、その場で本社に連絡して確認をとり、可能な限り対応します。

このような姿勢を当たり前のことと考える従業員が多い点、私は誇りに思っています。お客様から「TOWAはここまでやってくれる」と感謝される場面が数多くありますし、企業文化として自然に根づいてきていることが、何よりもうれしいのです。

【今後の事業に対する構え】

時代の変化を成長の機会ととらえ、新たな価値の創造に挑む

2022年から、「TOWA ビジョン2032」のもとで10年先を見据えた事業を進めています。今だから言えることですが、2014年当時、「10年後に売上高500億円を達成しよう」と目標を掲げた際、正直なところ、どの事業でどれだけ売上を積み上げていくかという明確な構想は私の頭の中にありませんでした。言ってみれば、それは夢物語だったわけです。とはいえ、夢を現実にするために、一生懸命に取り組もうという強い気持ちが出発点でした。

ありがたいことに、さまざまな施策を積み重ねていく中で、数字がついてきました。そして2022年、ビジョンは一つの区切りを迎え、今は次の10年先を見据えて、「売上高1,000億円」という目標に向けて動いています。この目標については、明確なビジョンのもとでロードマップを描き、達成に向けて確度の高いものと考えます。

売上高1,000億円に向けた新たな収益機会について申しますと、近年は2.5Dや3D実装、チップレットといった言葉をよく耳にします。同時に、前工程、後工程に加えて、「中(なか)

そして、これまで培ってきた企業文化を次の世代にきちんと受け継いでいくことが、会長となった私が率先して担うべきものだと感じています。私は創業者と幾多の試練を乗り越えてきた世代の人間です。そこで培った創業の原点を大切にして、次代を担う人財を育て、技術の研鑽と並行して将来への布石を打っていくことが、私のこれからの責務だと考えます。

工程」というまだ明確な定義が定まっていない言葉が出てきました。前工程だけで2ナノ、さらにその先の1ナノを目指す技術開発が続いているのに対して、コストと生産性のバランスを考えると、本当にそれでよいのかという議論の中で出てきた概念です。ここに当社の技術が貢献できる新たなニーズと収益機会が生まれつつあります。

一方で、米国は、2022年に中国への14nm 世代プロセス以下の先端半導体製造装置などに厳しい輸出規制をかけました。しかし翌年には、中国メーカーが製造した7nm 半導体のスマホへの搭載のニュースが流れました。先端設備がなくても、レガシー設備を駆使することで製品を成立させる。これもまた技術の力です。こうした事例を見るにつけ、最先端の微細化技術だけをひたすら追いかけるのではなく、収益性という観点から、前工程と後工程の連携を図ることの重要性が高まっています。こうした動向を的確にとらえていくことで、当社は新たな取り組みに挑戦し、事業をさらに大きなものにしていきます。

【次代を見据えた人財の育成について】

「TOWA アカデミー」を基軸に、理念と挑戦思考を継承する仕組みづくり

次の成長に向けて、最重要課題は人財の育成です。10年後、20年後、さらにその先も業界トップであり続けるために、第二次中期経営計画にて「TOWA イズムで次世代をリードする人財を創出する」というテーマを掲げて人財の育成に取り組んでいます。

具体的な取り組みの一つとして、「TOWA アカデミー」を本格的に立ち上げました。これまで準備室として動いていた組織を発展させ、企業理念の継承と技術の伝承を担う仕組みとして再編したものです。このアカデミーでは、知識の伝達にとどまらず、TOWA の根幹を成す価値観や、ものづくりに対する姿勢を次世代に浸透させていくことを目的と

しています。また、未来のTOWA を担うリーダーの育成にも力を入れており、経営理念でもある「挑戦思考」を備えた人財の登用や教育にも注力しています。

加えて、人財育成の取り組みの一環として、阪神タイガースの元監督である矢野輝弘氏を社外取締役役に起用しました。矢野氏は、当社の事業とは異なる世界で活躍されてきた方ですが、監督を退任されてから、講演活動をはじめ、筋ジストロフィー患者や児童養護施設の子どもたちへの支援など幅広く活動しています。私が注目したのは、矢野氏が監督という立場で培ってこられた人財育成の視点です。企業経営とは異なるフィールドではあるものの、組織を率いていくと

いう点では共通する部分が多くあります。矢野氏が経験をもとに語る言葉には、私たちとは異なった角度からの気づきや学びがあるはずです。

経営トップが「人財育成を大切にすると」発信しても、必ずしも組織の中に浸透するとは限りません。しかし、矢野氏のようにプロ野球の世界で経験を積まれた方が語ることで、従業員一人ひとりが「そうか、そういう考え方もあるのか」と

【将来に向けてのメッセージ】

精密金型というコア技術を礎に、次の10年も夢に突き進む

「TOWA ビジョン2032」のゴールである2032年に向けて、半導体ビジネスは引き続き成長していきます。それとともに、当社も引き続き成長を続けていきます。今後、半導体製造の後工程でさらなる強みを発揮するのに加えて、前工程での取り組みが進むことで、新たな市場を拓く手応えを感じています。2032年に売上高1,000億円、営業利益250億円を目指して着実に前進していきます。

半導体事業以外では、規模としてはまだ小さいながらも、グループ会社の株式会社バンディックが手がける医療機器の受託生産事業が着実に成長しています。現在では売上高が20億円を超え、さらに30億円に到達しそうな勢いです。将来的には100億円規模に育つ可能性があると考えています。また、TOWA レーザーフロント株式会社によるレーザ関連の事業も期待の一つです。

さらには、当社の中核技術である精密金型技術を応用した、工具事業にも期待しています。創業以来、社内の精密金型の生産現場で使用するエンドミル工具にはノウハウがあり、加工プロセスとともに工具の開発と内製を進めていました。この社内向け工具を外販したことが工具分野に進出したきっかけでした。年間の売上高はまだ5億円程度にとどまっているものの、TOWA のコア技術に関わるものであり、製品開発は継続していきます。工具事業が10年後、あるいはその先に、第二、第三の柱になってくれることを期待しています。そういった意味で、今は未来のための種まきをしているところです。

こうした半導体分野以外の事業を加えることで、1,000億円という目標を超えて2,000億円、あるいは3,000億円という可能性だって見えてくると思っています。10年前に社内呼びかけたように、今また私は「夢を見よう」と呼びかけたいのです。

最後に申し上げたいことは、TOWA の事業の本質です。それはまさに精密金型技術にあります。極論ではありますが、仮に半導体の設備ビジネスがゼロになったとしても、精密金型技術さえあれば、当社は存続できると私は本気で思っています。それほどまでに、当社の技術の中核を担う価値です。だ

感じ取り、心に響くものがあるのではないかと判断したのが招聘した動機です。矢野氏に「ぜひ、当社のために手伝ってください」とお願いしたところ、快く引き受けていただきました。今後、「TOWA アカデミー」の取り組みをさらに意味のあるものにしていく上で、大きな力になっていただけると期待しています。

からこそ、精密金型技術については、どんなことがあっても強化し続けます。この姿勢は今後も一切ぶれることはありません。

そして、この想いを次の世代を担う人々に確実に伝えていかなければなりません。数字だけを見ると、半導体製造装置の売上高が精密金型の倍ほど大きいのは事実です。しかし、精密金型というコアがあるからこそ、我々はここまでやってこられたし、これからも会社が存続できるわけです。この意識だけは徹底して、全員にしっかりと植えつけていかなければならないと、強く感じています。

直近、半導体市場は景気の勢いが欠けている上、主要国の関税措置の影響もあって、各社とも設備投資に慎重になっている面があります。しかし、あくまで瞬間的な動向であり、いずれ回復の流れは必ず戻ってきます。ですから、目の前の環境に左右されることなく、しっかりと先を見据えた対応を続けていくことが大切だと考えます。

そして、企業は同じ動きを続けているだけでは存続できません。時代に応じて、どう変化していくか、どう自らを変えていけるか。それこそが企業の基本であり、成長と存続の鍵です。私自身、その意識を常に持ちながら、これからのTOWA の成長を促していきます。



社長メッセージ



取締役 社長執行役員

三浦 宗男

技術と人財を軸に、TOWAらしい挑戦を通じて、次代の半導体産業に貢献してまいります。

【社長就任にあたって】

技術と営業の現場経験を活かし、変革期のTOWAを牽引

2025年4月より、取締役社長執行役員に就任いたしました三浦宗男です。半導体産業が大きな転換期を迎える中、かかる重責を担うことに、身の引き締まる思いです。

私は1990年に当社に技術者として入社し、半導体のモールドイング、つまりパッケージングを行う金型の設計に携わってきました。8年後にはシンガポールに新設された工場の立ち上げメンバーとして赴任。当時は東南アジアのお客様が多く、現地で設計や製造をきめ細かく行う体制を整えていきました。結果として、約12年間シンガポールに滞在し、東南アジアだけでなく、中国や台湾といった中華圏のお客様への対応にも従事しました。2010年以降、日本に帰任してからは営業畑を中心に業務に携わってきました。

この四半世紀の中で、半導体製造のあり方は大きく変化しています。私が入社した当初は、ミクロン精度の精密さや平坦度といった加工技術が問われていた時代でした。しか

し、2000年を越えたあたりからお客様が製造装置に求めるものが変わってきました。高性能な加工機が入手しやすくなり国外でもそれなりの精密加工が可能となってきました。精密加工ができるのは当然として、加えて高品質な半導体を、安価かつ安定的に製造できるかというプロセスそのものが問われるようになってきたのです。すなわち、それほど精密でなくても品質を担保できて生産性が高く、結果としてコストダウンにつながる装置が求められてきました。精密金型技術は今もお当社の中核を担うコア技術であり競争力の源泉です。しかし、それだけでは通用しなくなっており、品質と生産性、そしてコストパフォーマンスのバランスが求められているというのが、昨今の市場の現実です。

これに対して、当社では創業者が「クォーター・リード」と呼んだように、顧客ニーズの4分の1歩先を見据えた技術開発に徹することで、時代ごとの課題に的確に応え、そ

れが事業の成長につながってきました。トランスファ方式やコンプレッション方式など、他社の追随を許さない画期的な樹脂成形技術を通じて、半導体製造の後工程において揺るがぬ事業基盤を確立しています。また、材料メーカーの方々と連携しながら、「この成形技術にとって本当に必要なプロセスとは何か」という本質的な問いを突き詰め

てきました。こうした粘り強い取り組みの結果が、技術的な成果として結実しているのだと考えています。途中であきらめてしまえば、技術はそこで止まってしまいます。しかし、私たちには「あきらめない」という企業風土があります。それが技術の進化を支える原動力になっていると実感しています。

【第一次中期経営計画の振り返りと足元の課題】

持続的成長に向けた重点領域の強化と技術の横展開

「第一次中期経営計画」(以下、「第一次中計」)につきましては、最終年度の売上高600億円を目指して取り組んできました。2020年度には売上高500億円を達成したものの、その後の半導体産業の景気後退の影響を受けて、半導体メーカー各社が設備投資に慎重になったことを背景に、最終年度の600億円達成には至らず、力及ばずという結果となりました。

もっとも、当社は先端分野を含めて、お客様の最も難易度の高い課題に対応しながら、需要を自ら創出するというスタンスを貫いてきました。その結果、AI分野の成長が顕著な中で、当社の装置が同分野のメモリで100%のシェアを確立したことで、お客様からの集中投資が続き、「第一次中計」の3年間で500億円超の売上高を維持できました。

一方、足元の課題としては、当社の主力である半導体のモールドイング装置に関わるビジネス機会です。世界各地に販売拠点を持っており、それぞれの地域で装置の販売が伸びれば、アフタービジネス、すなわち部品供給やメンテナンスといったサービスが比例して拡大するというビジネス構造を有しています。これまでTSS(トータル・ソリューション・サービス)として取り組んできたことですが、現地主導でアフターサービスが

できるよう、投資を進めているところです。従来、当社製品は技術やブランドとして競争優位を築いてきたものの、中国市場では国策としての補助金を背景に、競合製品が急速に増えてきました。こうした状況から、当社では体制を構築して、東南アジアや中国など現地拠点で対応可能な部分については現地化を進め、アフタービジネスの幅をさらに広げていく考えです。

また、先端装置の開発、販売については圧倒的な競争力を発揮しているとはいえ半導体業界全体を見ると先端分野はピラミッドの頂点に過ぎず、むしろミドルレンジやローエンド市場の方が裾野が広く、ボリュームも大きいのが実情です。現状、利益が出づらいという理由で十分に対応できていないことに対して、こうした領域においてもお客様のご要望に即した製品づくりを強化し、シェアの獲得を目指していきます。

また、当社が40年以上かけて築き上げてきたプレス装置やハンドリングの技術を半導体のモールドイング工程以外でも活用したいというお声が増えており、現在、さまざまなご相談をいただいています。今後、既存技術の横展開という位置づけで半導体業界の中で技術の幅をさらに広げ、対応領域を増やしていくという方針で取り組んでいきます。

【2025年度の課題と取り組み】

成長投資の加速と半導体市場回復局面への対応力強化

2025年度より第二次中期経営計画(以下、「第二次中計」)がスタートしました。この一年は、2032年の売上高1,000億円に向けて様々な挑戦に本格的に取り組む年と位置づけており、目標の実現に必要な体制を整えることが重要だと考えています。「第一次中計」ではこの長期ビジョンの目標を見据えた基盤強化を進めてきましたものの、まだ現時点で工場の生産能力は1,000億円の売上高を支えるには十分ではありません。そのため、生産体制を拡充して将来の需要に確実に対応していくための投資が不可欠だと判断しています。「第二次中計」におけるROEや配当性向の目標については、さまざまな見方があるかと思いますが、株主・

投資家の皆様への利益還元を重視しており、可能な範囲で配当性向を高めてまいります。当面の方針として、将来の成長に向けた投資を優先させていただいております。

2025年度以降の市場については、さまざまなお客様と対話を重ねる中で、半導体サイクルについては、底を打ち、再び上昇に転じるタイミングを迎えていると実感しています。半導体業界の需要の動きには大きな変動の波がありますが、長期的に見れば右肩上がりの成長カーブを描いていることに疑いはありません。2022年に大きく売上が伸びた後、多くのお客様が在庫を積み上げた結果、一時的に需要が落ち込んだものの、ここにきて納期の適正化が進み、売上は再び増加傾向にあります。

こうした状況において、当社ではお客様の設備投資のタイミングを見極めるため、いくつかの指標を重視しています。中でも重要なのがお客様の製造ラインの稼働率です。AI 関連の分野を中心に、一部のお客様では極めて高い負荷で生産が行われている状況です。一方で、主要国の関税措置が影響し、多くのお客様が「先行きの不透明さ」に懸念を抱いていることも事実です。稼働率が高まりつつあるとはいえ、設備投

資に踏み切るタイミングを慎重に見極めているのが実情です。そのため、当社においては、次に需要が一気に立ち上がる時期を見逃すことなく、注文にタイムリーに応えられる体制を整えています。半導体サイクルの回復局面においては、瞬間風速のように注文の集中が起きがちです。こうした状況に備えて、当社はさまざまな対応策を検討し、回復需要をしっかりと捉えるための準備を怠りなく進めています。

【半導体製造装置の革新】

後工程の高度化が切り拓く新たな市場機会

AIの進化により大きな変化を迎えている半導体業界に対して、当社は的確に対応してまいります。生成AI向けGPUに欠かせない広帯域メモリ「HBM」に当社の技術が採用されている背景には、実装技術の進化が深く関係しています。従来のフリップチップ実装では、テープによる固定やキャピラリーアンダーフィルによる隙間充填の後にモールドディングを施すという工程が主流でした。これに対して、当社は「モールドアンダーフィル(MUF)」という技術を提案しました。これはコンプレッション方式による真空成形を用いて、パッケージ内部の隙間を一括して充填する封止技術です。

このMUF技術には、工程の簡略化や使用材料の削減、さらには生産性を大きく向上させることができる利点があります。また、一体成形により放熱性を向上させることが可能であり、その有効性が実証されています。

さらに、当社は2.5D実装やチップレットといった新たな技術領域に挑んでいます。先端半導体チップ製造の前工程では回路幅の微細化が限界を迎えつつあり、高コスト化も進むことから、後工程や中工程と呼ばれる領域からの技術アプローチが注目されています。そうした潮流の中で、当社の封止技術や個片化技術が貢献できる市場機会が拡大しています。

一方、モールドディング装置に次いで重要な製品であるシンギュレーション装置については、業界に先駆け1990年

代後半から開発を開始し、売上を伸ばしてきました。しかし、従来のダイサーやハンドラを用いた方式の装置では競合が激しく、モールドディング装置のような収益を上げるのが難しい状況が続いていました。

これに対して、数年前にあるお客様から「より高速のシンギュレーション装置を開発してほしい」との依頼をいただき、従来の発想と異なるレーザによる切断に取り組むこととなったのです。試行錯誤の末、今年からプロトタイプの出荷を実現したところ、評価が高く、お客様先の生産ラインへの導入が進んでいる段階です。

このレーザシンギュレーション装置は、生産性が従来の2倍に向上しており、これまで2台必要だった装置が1台で済むようになったことで、省スペース化にも貢献しています。また、スマートフォンやタブレット、ウェアラブル機器などでは、バッテリーサイズをできる限り大きくしたいという意向が強く、その分、半導体を制限されたスペース内で配置しなければならず、場合によっては異形状の切断が求められます。これは従来のダイサーでは対応できず、当社のレーザだからこそ対応可能となっています。当社では、新たなレーザ技術を軸に、モールドディング装置と同様に「世の中にない、より良いもの」を提案していくことで、事業の幅を拡大していく考えです。

【新規事業の育成】

将来の成長を見据えた事業ポートフォリオの構築

「第二次中計」においては、半導体分野のさらなる成長を加速させていく一方で、事業ポートフォリオの見直しを進めていく考えです。

現在、当社の売上の約9割は新事業・TSS(トータル・ソリューション・サービス)を含む半導体事業によって構成されていることから、今後、半導体の需要が停滞すれば業績に大きく影響が出かねません。そのため、半導体関連への

依存度を緩和することで、半導体市場が仮に低迷しても、収益を安定的に確保できるポートフォリオの構築に注力していきたいと考えています。

具体的には、コア技術に関連した半導体分野以外の用途開拓をはじめ、エンドミル・ドリルの工具、離型フィルム、医療機器、レーザ加工装置など、TOWAグループ内で取り組む新規分野の育成を進めていきます。「第二次中計」は投資

フェーズと位置づけており、これらのうち一つ、二つの事業について成長軌道に乗せていきたいと考えています。この点、あまりに早期の収益を求めすぎると、当社の強みであるチャ

レンジ精神が損なわれかねません。ですから、腰を据えて取り組みながらも収益性を重視し、新たな事業の柱を着実に育ててまいります。

【次代の成長を見据えた人財育成】

人財力の最大化に向けた基盤づくりと実践教育の強化

2032年に売上高1,000億円を目指すという目標に対して、人財の採用、育成が重要な課題であることは言うまでもありません。一方で、少子高齢化の進行に伴い、日本国内での人財確保は一層困難な状況となっています。毎年、数多くの方を採用して育成に努めているのと併行して、教育研修を通じて優秀な人財を育てる観点が重要です。「機能する人財をどう増やしていくか」が今後の大きな課題だと考えています。

AIが本格的に普及していく時代にあって、従業員一人当たりの生産性を高めることが、企業競争力の強化に直結します。それと同時に、AIを活用したDXを推進していくことで仕事の進め方を見直し、業務における無駄を省い

ていく施策が欠かせません。私自身も、地道にAIを使いながら日々の業務に取り組んでおりますが、任せられる部分はAIに任せ、その分、従業員一人ひとりの生産効率をいかに高めるかという視点が求められます。そういった取り組みを一つの柱として、これからの3年間で人財の効率的な活用、すなわち「人財の最大化」に集中して取り組んでいきます。

当社には、これまで蓄積してきた多くのデータやノウハウがあります。これらをいかに効率よく活用していくかが、今後の成長の鍵になると考えています。その意味でも、AIの導入、活用は単なる技術面の施策ではなく、社内人財育成の一環として位置づけて取り組んでいきます。

【TOWAのさらなる使命】

世界市場での構造変化を見据えつつ、日本の半導体産業の再興への貢献も目指す

半導体産業に長年携わってきた中で強く実感しているのは、米国における巨大IT企業群の存在の大きさです。彼らが「こういうものを作りたい」と決定すると、その指示がデバイスメーカーへと伝達され、最終的にはアジアの企業群がそれを製造するという構図が形成されています。当社もこの流れの中で、間接的に装置や材料を提供しているのが現状です。必要な対価だけを受け取りつつ、言われたとおりに作るだけという立場に甘んじているのが現状です。

その一方で、巨大IT企業はその製品を活用して何十倍、何百倍もの利益を上げており、この構造に対して私個人として強い問題意識を持っています。私がTOWAに入社した頃は、日本の半導体産業が非常に強い時代で、当社の売上はほとんどが日本のお客様によるものでした。ところが現在では9割近くが海外のお客様によるものとなっています。

こうした現状を少しでも打開したいというのが私の願いです。海外のお客様の課題にこれまで以上に応えることは当然として、国内の装置メーカーや材料メーカーなど、関係する企業同士が横でつながり、世界に通用する日本発の企業群を目指すことも必要だと考えています。これによって、「こういうものが社会にとって必要だ」と日本の企業群が方向性を示し、デバイスメーカーに「これを作ってほしい」

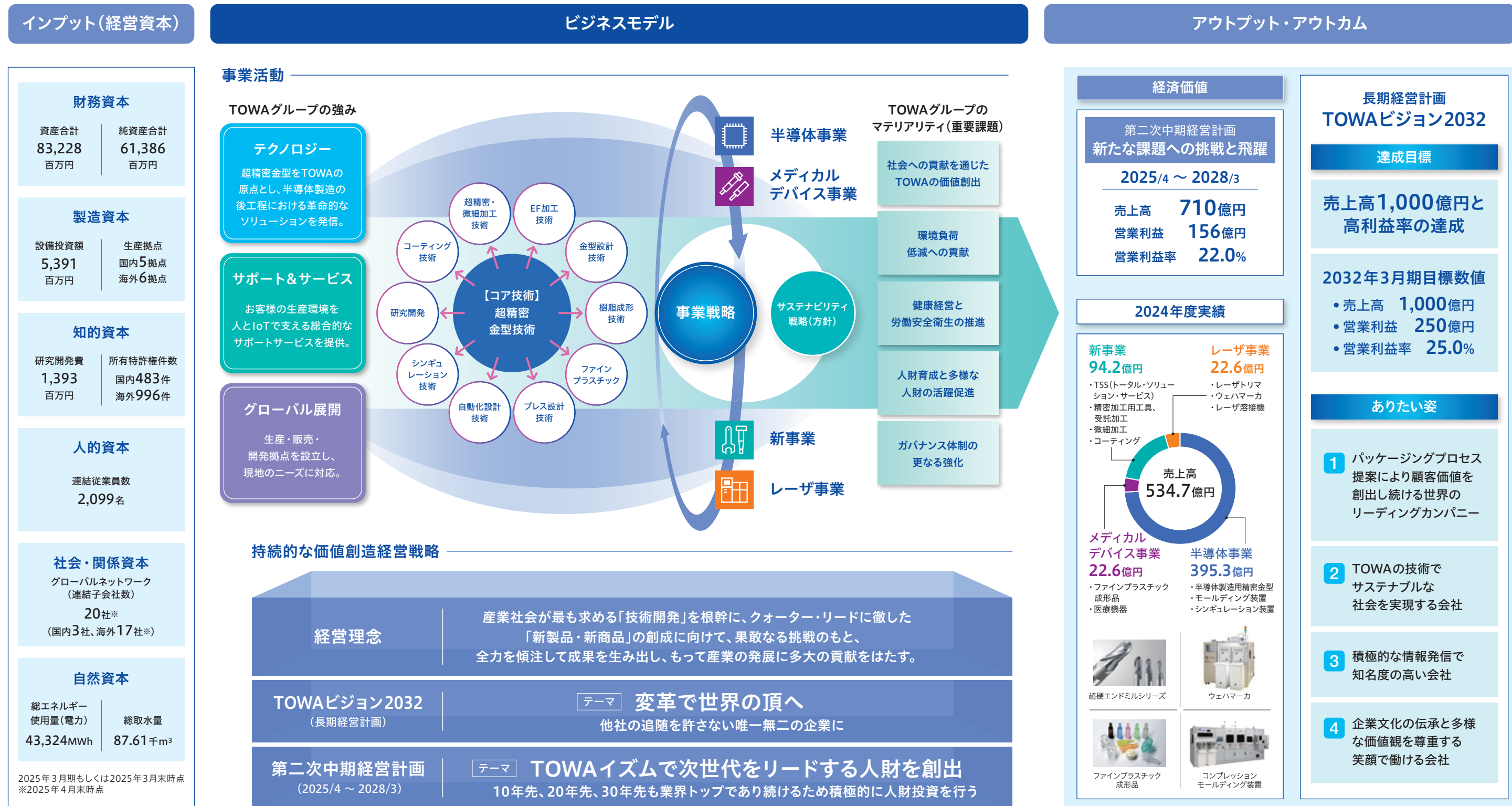
と指示できる構造を構築することで、日本の半導体産業を再興したいと願っています。近年、国内でも先端ロジック半導体の開発・量産を目指す動きが出てきています。当社としても、今後こうした進展に寄与し、日本の半導体産業に貢献していくことが私の夢です。これからの時代におけるビジネスの潮流をしっかりと見定めつつ、技術と人財を軸に、TOWAらしい挑戦を通じて、次代の半導体産業に貢献してまいります。



CHAPTER 02

TOWAグループの価値創造プロセス

さまざまな用途で半導体需要が急増する中、TOWAグループに対するお客様の期待はますます大きくなっております。サステナビリティの実現などの社会課題解決への貢献を見据え、当社にしかできないビジネスモデルを構築して今後もさらなる成長と企業価値の向上を追求し、唯一無二の企業を目指します。



持続的な価値創造経営戦略

経営理念

産業社会が最も求める「技術開発」を根幹に、クォーター・リードに徹した「新製品・新商品」の創成に向けて、果敢なる挑戦のもと、全力を傾注して成果を生み出し、もって産業の発展に多大の貢献をはたす。

TOWAビジョン2032
(長期経営計画)

テーマ 変革で世界の頂へ

他社の追随を許さない唯一無二の企業に

第二次中期経営計画
(2025/4 ~ 2028/3)

テーマ TOWAイズムで次世代をリードする人財を創出

10年先、20年先、30年先も業界トップであり続けるため積極的に人財投資を行う

TOWAグループの培った強み

TOWAには、ものづくりにかける思いをひたむきに研究・開発に注いだ先人たちが、長年かけて築いてきた技術基盤があります。この基盤を最大の強みとして、アフターサポートをはじめとするトータル・ソリューション・サービスを拡充。開発・生産・販売拠点を世界に拡大し、お客様のすぐそばで、開発から製造、供給までご要望に迅速かつ適切にお応えしています。

- コア・コンピタンス ～ 超精密金型を創出してきた金型関連技術
- 市場ニーズを先取りするソリューション提案型の開発

当社は、超精密金型技術をコア技術とし、超精密金型加工、樹脂成形、装置設計に関わる革新的な技術開発を推進してきました。半導体をはじめ光学・医療など多分野に応用可能な**超精密・微細加工技術**の研究を重ね、業界の技術革新に貢献しています。

独自の**コーティング技術**であるバンセラコーティングは、金型の耐久性・離型性を向上させ、さらには金型だけでなく機械部品やガラス等への表面処理に幅広く応用されています。複雑な形状と高い精度を必要とする金型の量産に有効なプロセス技術である**EF(超精密電鍍)加工技術**は、超精密金型の大幅な生産性の向上とコストダウンを図ることができます。

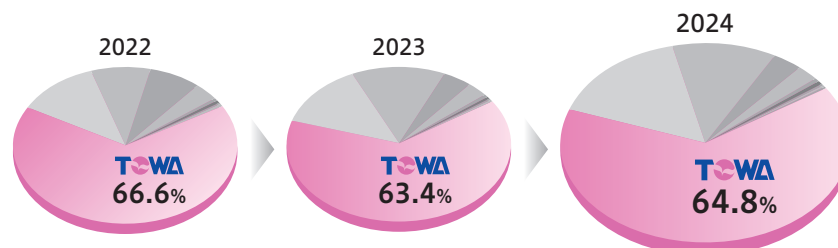
当社は、3D CADとCAE解析を活用した**金型設計技術**により、最適な設計プロセスを構築し高品質な金型を提供しています。**樹脂成形技術**としては、半導体モールドディング市場において業界標準を確立して以来、リーディングカンパニーであり続けています。**プレス設計技術・自動化設計技術**を強みとし、常に市場のニーズを先取りしたモールドプロセスを提案し、お客様の求める納期・品質に対応しています。また、創業時から培ったエンジニアリングプラスチック成形技術により、**ファインプラスチック**の多様な製品ニーズにもお応えしています。

業界に先駆けて1990年代から当社が取り組んでいる半導体後工程の**シンギュレーション技術**では、長年培ってきた切断技術に、高速なハンドリング技術や画像解析技術を結合して、高い品質で製品を個片化する装置を提供しています。



数字で見るTOWAの現在地

半導体モールドディング装置世界シェアの推移



※TechInsights 社のデータをもとに当社作成

テクノロジー

サポート & サービス

TOWAの成長を支える三つの強み

グローバル展開

● Total Solution Service(TSS)

- サポートサービス
- 部品供給サービス
- 生産性向上サービス
- 付加価値提案
- サポートシステム TEN-System

● トレーニングセンター

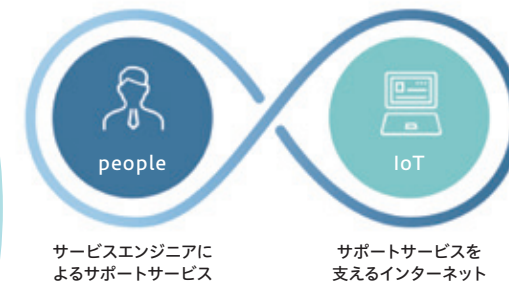
● ラボラトリ

TOWAでは、製品を導入いただいたお客様にさまざまなサポート&サービスを提供しています。

Total Solution Service(TSS)は、お客様の生産環境を人とIoTで支える、総合的なサポートサービスです。

トレーニングセンターでは、当社装置をご使用のお客様に、より安全かつ安定した稼働に役立つ知識と技術を習得していただけます。

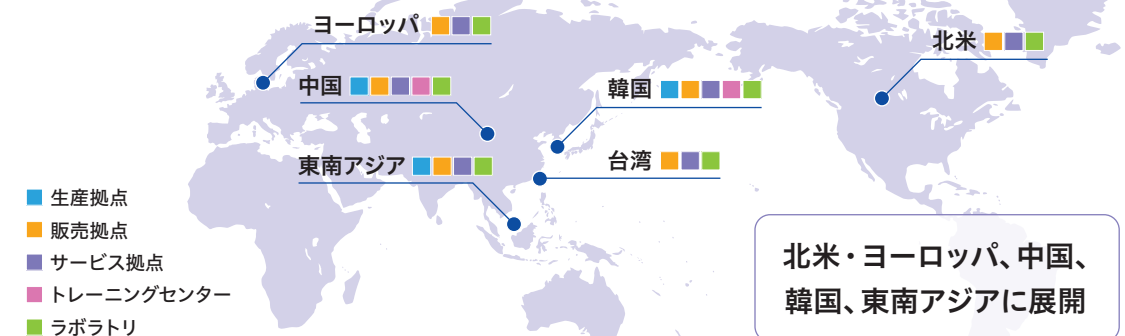
ラボラトリでは、パッケージ開発支援体制を整え、顧客パッケージ開発期間の短縮、モールドディング・シンギュレーションプロセスを提案しています。



- 主要な半導体生産地域に販売拠点および生産拠点を展開
- 市場変化に柔軟に対応できるサービス体制を構築

顧客ニーズへの即応性を高め、顧客満足の向上を図るため、主要な半導体生産地域に販売拠点および生産拠点を展開しています。

お客様のすぐそばで、あらゆるご要望に迅速かつ適切に応えてまいります。



TOWA グループの技術と製品

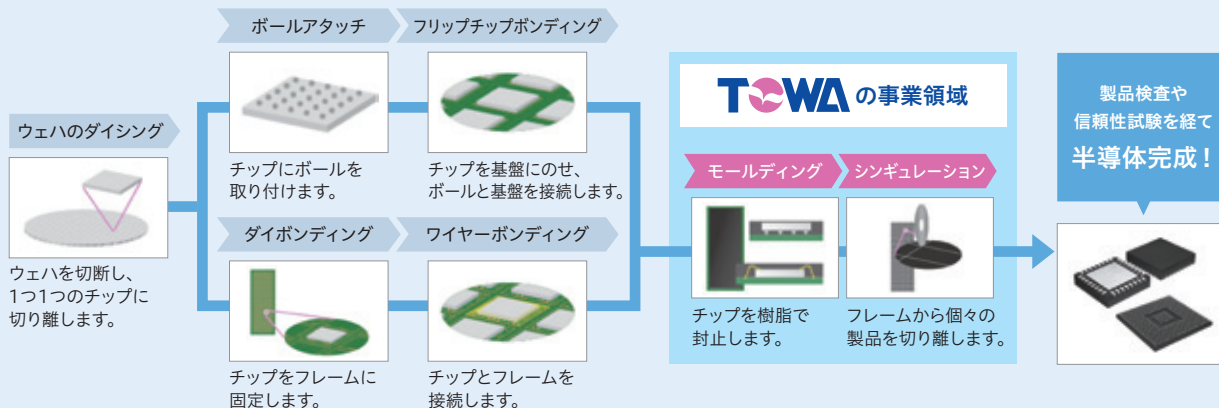
TOWAグループにおける最大の強みは技術です。特に半導体製造の後工程では最先端技術を世界に発信し続けてきました。原点は、超精密金型のモジュールシステムの開発であり、そこで培われた超精密微細加工技術が、医療デバイス事業や新事業への足がかりとなりました。いまだ他社の追従を許さないコンプレッションモールドはじめ、多彩な技術が世界のテクノロジーの発展に役立っています。

半導体

半導体製造における後工程の革命的ソリューション

前工程と後工程について

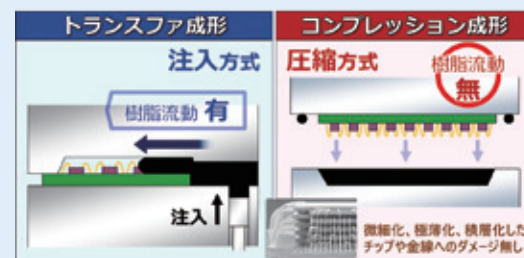
半導体の製造には前工程と後工程があり、当社は後工程で使われる装置を製造するメーカーです。後工程には、半導体チップを基板の上に並べる、金線をつなぐ、樹脂で覆いチップを保護する、カットして個片化する、動作をテストするといった工程があります。チップを樹脂で覆う(=封止する)工程をモールドイング、個片にカットする工程をシングュレーションといい、当社ではこれらの装置の性能を徹底的に追求してきました。



モールドイングで圧倒的地位を築いたコンプレッション装置

モールドイングには従来、閉じた金型の窪みに樹脂を注入するトランスファ成形という方法が使われていましたが、注入時の樹脂の流動で金線が歪み、デリケートなチップにダメージを与えるという問題がありました。それを解決したのが独自のコンプレッション装置です。樹脂の中に浸すことで流動の影響を取り除いたコンプレッション(圧縮)成形方式により、最先端製品の封止と大幅なコスト削減が可能となりました。

コンプレッションモールドは、2.5D、3Dパッケージなどの次世代パッケージに最適であり、自動運転、5G、AI、IoTなどの次世代技術で加速的に拡大する半導体需要を見込んだ成長が期待できるため、当社の技術的な強みとなっています。



トランスファ成形→コンプレッション成形によるパッケージソリューション。メモリなどのハイエンド製品にコンプレッション成形は欠かせなくなっている。

高品質化と生産性向上に貢献するシングュレーション装置

モールドイング工程で封止されたパネル状の半導体の一つひとつの個片に切り分けるのがシングュレーション装置です。当社の装置は1mm×1mmの個片化が可能で、業界最小を誇ります。当社グループで開発製造を行っている切断用ブレードと合わせたソリューション提案も強みです。

省人化を実現し生産性と環境性能を向上させた「FMS4040」の拡販を進めています。また2025年3月には、グループ会社のTOWAレーザーフロント株式会社と共同開発したレーザシングュレーション技術を搭載し、任意の形状での切断が可能なうえ生産性を向上させた「LGS1040」を市場投入しました。



医療デバイス

ナノテクを生かしたプラスチックの成形加工で医療に貢献



医療デバイス事業は医療機器が中心となっており、医療注射器、点滴用部品といった医療用ファインプラスチック成形品などの受託生産を行っています。独自の超精密・微細加工技術で製作された金型による高精度な量産成形と、クリーンルーム設備での「射出成形～組立」をコア技術とした検査・出荷までワンストップでの生産が特徴です。開発品や小ロットから量産に至る成形まで、お客様のニーズにお応えしています。環境に配慮したバイオマスプラスチック・生分解プラスチックへの取り組みも行っています。

新事業

TOWAのコア技術を応用した新規事業の展開

金型の超精密加工技術を支える自社開発のエンドミル(工具)の販売、超精密加工技術やコーティング技術を応用した受託加工ビジネス、当社半導体製造装置のアフターサービスや改造・修理、中古機の販売までトータルで提案するTSS事業を展開しています。



CBNエンドミルシリーズ

レンズ成形型(左)とゴム成形型(右)

長期ビジョン「TOWAビジョン2032」

2022年3月、世界において他社の追随を許さない唯一無二の企業を目指し、パラダイムシフトを図りこれまでと全く違った一段高いステージへ上がるため、10年後に向けた新たなチャレンジ、長期ビジョン「TOWAビジョン2032」を策定しました。

長期ビジョン
「TOWAビジョン2032」

テーマ「変革で世界の頂へ」

世界の頂とは、文字通り世界のトップであり、他社の追随を許さない唯一無二の企業になることです。そのために段階的に達成すべき目標を設定するとともに、今後TOWAがどのような企業であるべきかを改めて問い直し、10年後のTOWAの「ありたい姿」を4つの目指すべきポイントに整理して定めました。

第一次中期経営計画

第二次中期経営計画

第三次中期経営計画

「世界の頂」への
基盤強化新たな課題への
挑戦と飛躍売上高1,000億円と
高利益率の達成

2022/4 ～ 2025/3

2025/3月期実績

売上高	534.7億円
営業利益	88.8億円
営業利益率	16.6%

2025/4 ～ 2028/3

2028/3月期目標数値

売上高	710億円
営業利益	156億円
営業利益率	22.0%

2028/4 ～ 2032/3

2032/3月期目標数値

売上高	1,000億円
営業利益	250億円
営業利益率	25.0%

TOWAビジョン2032の業績目標において、2032年3月期までの10年間で三つのフェーズに分け、それぞれ第一次、第二次、第三次中期経営計画として取り組んでいきます。10年後の2032年3月期に、売上高1,000億円、営業利益250億円、営業利益率25%を目指します。

10年後(2032年)にTOWAが知りたい姿

TOWAビジョン2032の策定にあたっては、今後TOWAがどのような企業であるべきかを改めて問い直し、10年後のTOWAの「ありたい姿」を定めました。持続的に企業価値を向上し「世界の頂」に向けて進むため、会社と社員一人ひとりが想い描くべきより具体的な姿を示すものです。

1

パッケージングプロセス提案により顧客価値を創出し続ける世界のリーディングカンパニー

TOWAの誇るパッケージングプロセスに係る技術、ノウハウを提供することにより、お客様が得られる価値を創出します。

2

TOWAの技術でサステナブルな社会を実現する会社

TOWAの技術を様々な分野に活かし、持続可能な社会の実現に貢献します。

3

積極的な情報発信で知名度の高い会社

人財確保やBtoCを視野に入れた新たな事業展開においては、広く社会全般における知名度向上が必要と考え、積極的なPRに努めています。

4

企業文化の伝承と多様な価値観を尊重する笑顔で働ける会社

培ってきたDNAを10年後も伝承するとともに、時代の変化に応じた多様な価値観を認め、柔軟な対応で社員を大切にすることを目指します。

TOWAグループのマテリアリティ

社会への貢献を通じたTOWAの価値創出
環境負荷低減への貢献
健康経営と労働安全衛生の推進
人財育成と多様な人財の活躍促進
ガバナンス体制の更なる強化

また、このありたい姿に向けて取り組むべき課題、取り組み解決することで企業価値が高まる課題として、TOWAグループのマテリアリティを特定しています。持続的な「稼ぐ力」の向上と更なる価値創出へとつなげ、世界の頂を目指します。

TOWAビジョン2032の進捗概要

前長期ビジョン(2014年4月～2022年3月)では、2014年度に売上高171億円からスタートし、10年後の売上高500億円、営業利益80億円、営業利益率16%という大きな目標を掲げました。達成に向け、市場動向を先読みしつつ積極的な設備投資を行った結果、2022年3月期にその目標を2年前倒しで実現しました。

TOWAビジョン2032では、「変革で世界の頂へ」のテーマのもと、2032年3月期には売上高1,000億円、営業利益250億円、営業利益率25.0%という高収益率の達成を目指します。

2025年3月までの第一次中期経営計画では、「「世界の頂」への基盤強化」に重点を置き、新技術の開発や生産設備への投資を推進してきました。その成果として、TOWA独自のコンプレッションモールドイング装置・金型の拡販が進むとともに、次期中期経営計画の柱として期待されるチップレットに最適な装置「YPM1250-EPQ」や、新たなレーザシンギュレーションプロセスを搭載した「LGS1040」を開発・リリースしました。

また、人財に関する基盤の強化として、TOWAアカデミー準備室を立ち上げ、TOWAの技術を次世代へ伝承するための人財育成を進めるとともに、事業規模拡大に向けた人財の獲得にも積極的に取り組んできました。

2025年4月からは、第一次中期経営計画で強化した基盤をもとに、「新たな課題への挑戦と飛躍」の期間として売上高1,000億円に向かう第二次中期経営計画がスタートしました。



開発した生成AI向け半導体に対応したモールドイング装置Model YPM1250-EPQは産業タイムズ社主催の「半導体・オブ・ザ・イヤー2024」の半導体製造装置部門グランプリを受賞



TOWAのコア・コンピタンスである超精密金型技術の基礎を学ぶ「ものづくり研修」の様子

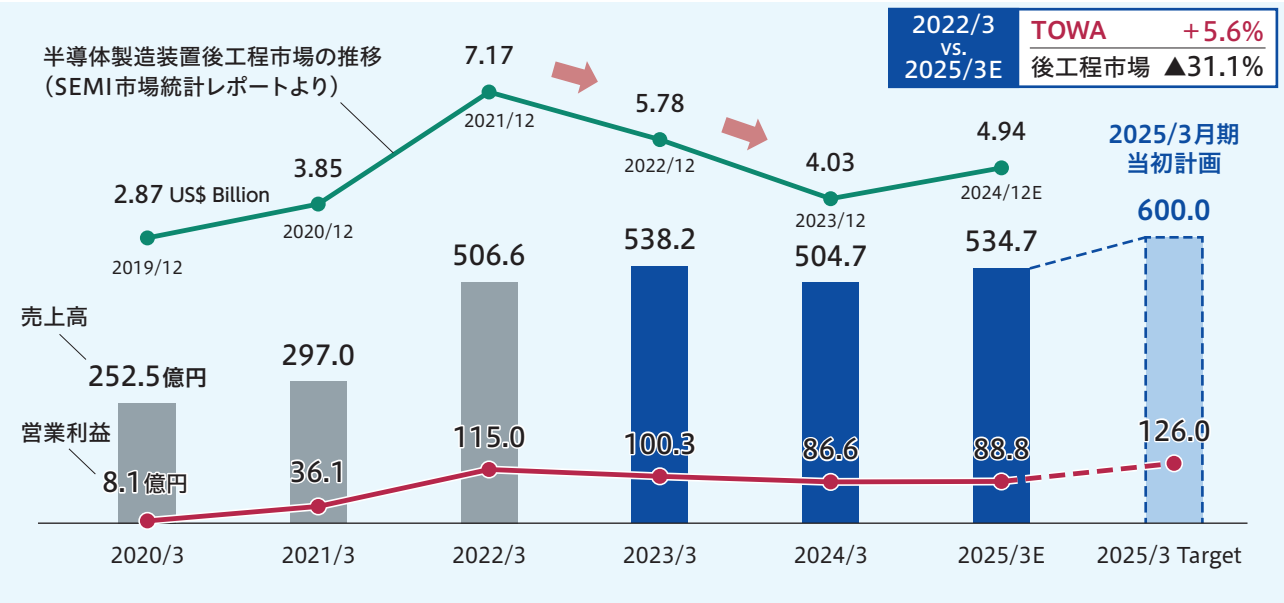
第一次中期経営計画の振り返り(2022/4～2025/3)

TOWAは、2022年3月期に以前の長期ビジョンを前倒しで達成したことから、新たな長期ビジョンを掲げ、その達成に向けて、3つの段階に区切り、それぞれ中期経営計画として取り組んでいます。

2023年3月期から2025年3月期までの3年間(第一次中期経営計画)では、この長期ビジョン達成に向けた基盤強化の期間と位置づけて、人員増や研究開発投資、設備投資を積極的に行ってまいりました。

第一次中期経営計画の成果 ～売上高500億円以上を安定して達成できる基盤を構築～

第一次中期経営計画の期間の数値目標は、半導体市場の低迷により当初計画を達成することはできませんでしたが、2022年当時、急激に拡大した売上高規模に対して脆弱であった事業基盤を強化することで、市場が落ち込んでいる時でも安定して500億円以上の売上高を達成できる体制を構築することができました。



事業別実績

第一次中期経営計画の最終年度2025年3月期実績は、この中期経営計画開始直前の2022年3月期実績、すなわち前長期ビジョン最終年度実績に対して、売上高は+5.6%の534.7億円となりました。この期間の半導体後工程市場の伸びが30%以上のマイナスであった中での増加となりました。

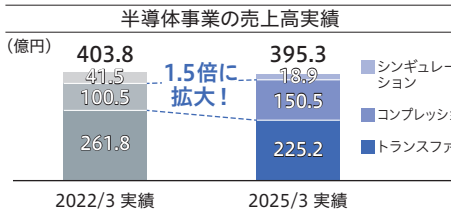
		2022年3月期 実績	→	2025年3月期 実績
売上高	売上計	506.6億円	+5.6%	534.7億円
	半導体	403.8億円	▲2.1%	395.3億円
	医療デバイス	17.2億円	+31.4%	22.6億円
	新事業	63.3億円	+48.9%	94.2億円
	レーザー	22.2億円	+1.3%	22.6億円
営業利益		115.0億円	▲22.8%	88.8億円
営業利益率		22.7%	▲6.1pt	16.6%

半導体市場の低迷により、半導体事業は若干のマイナス成長、レーザー事業は横ばいとなりましたが、医療デバイス事業と新事業については大きく成長させることができました。

営業利益は、人員増や研究開発投資、設備投資等を積極的に行ったため減益となりましたが、前述の通り安定して500億円以上の売上高を実現し、TOWAビジョン2032達成に向けた基盤を構築することができました。

半導体事業

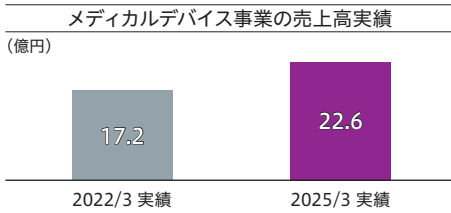
- TOWA独自のコンプレッションモルディング装置・金型を拡販
- 次期中計の柱となる市場競争力のある製品を開発
- トップシェアの維持とシェアをさらに拡大



TOWA独自のコンプレッションモルディング装置・金型の拡販が進み、生成AIなど先端パッケージ向け採用により売上高規模はこの3年で約1.5倍に拡大しました。また、開発したチップレットに最適な装置「YPM1250-EPQ」は、半導体・オプ・ザ・イヤー2024半導体製造装置部門でグランプリを受賞し、次期中計の柱として期待されています。半導体モルディング装置ではトップシェアを維持し、当中計期間において世界シェアは59.3%から64.8%に拡大※しました。 ※TechInsights 社データをもとに当社算出

医療デバイス事業

- クリーンルームを活用し、高付加価値製品の取り扱いを拡大
- 事業拡大に向け、生産エリアを増設

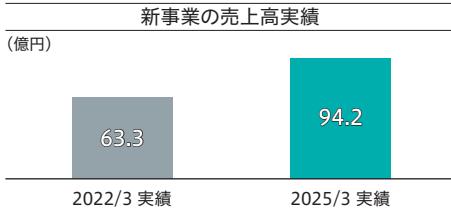


クリーンルームを活用し、医療用機器などの高付加価値製品の取り扱いを拡大しました。また、事業拡大のため生産エリアを増設し、生産能力を約30%増強しました。当事業は医療機器組立という技術が求められる分野で強みを持ち、その強みを活かした事業展開により、売上高を約1.3倍に拡大することができました。

※「化成品事業」は2025年4月より「医療デバイス事業」へ名称を変更しています。

新事業

- 累計装置納入台数の増加に加え、メーカー直結の付加価値の高いアフターサービスにより、TSS※の売上が増加
- リリースフィルムやブレードなどの半導体関連の消耗品を拡販
- 工具事業の海外展開を開始

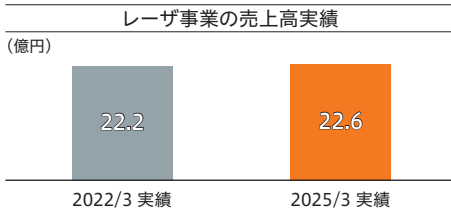


累計装置納入台数の増加やメーカー直結の付加価値の高いアフターサービスの提供により、TSSの売上が増加しました。またM&Aによりブレード事業を獲得し、半導体関連消耗品の取り扱いを拡大しました。工具事業では海外展開を開始し、事業拡大に向けた準備を進めました。これらの結果、新事業の売上高は約1.5倍に拡大することができました。

※TSS：トータル・ソリューション・サービス(半導体製造装置の部品販売やアフターサービス、リニューアルビジネスなど)

レーザー事業

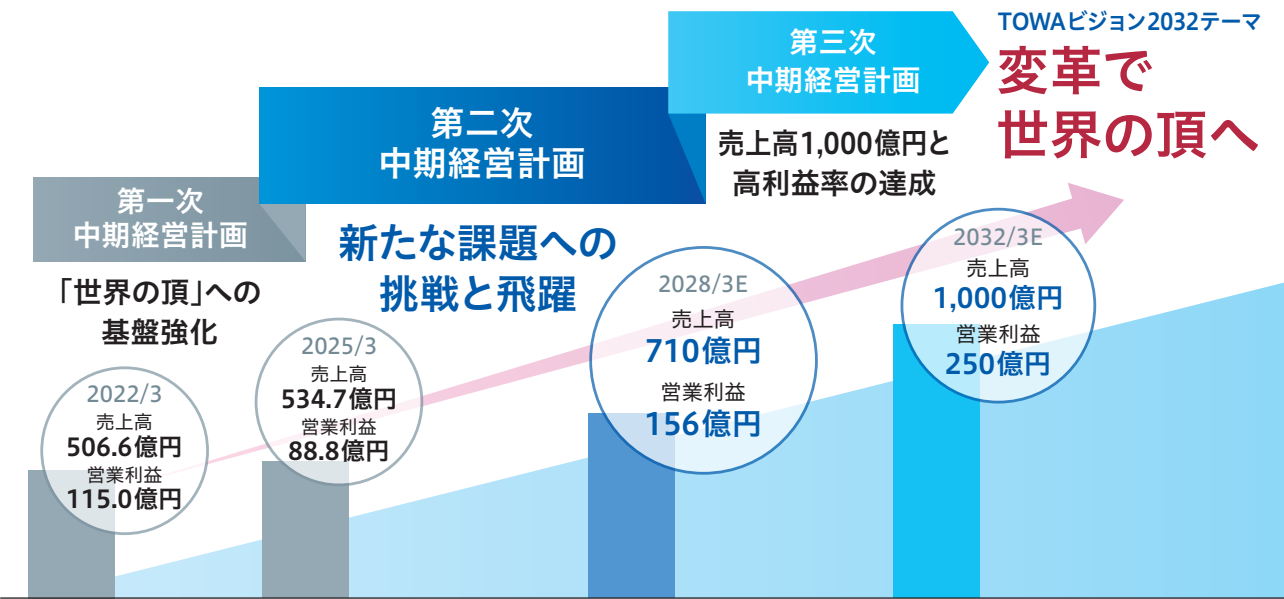
- 直販体制の推進により顧客対応を充実
- 半導体事業の販路を活用し海外顧客を開拓
- レーザープロセス技術を半導体事業へ展開



代理店を使った販売体制から直販体制に移行し、きめ細かなサービスと顧客ニーズの把握が可能になりました。半導体事業の販路を活用し、海外顧客の開拓を行って中国での需要も獲得しました。また半導体製造装置への展開を図っており、半導体切断プロセスにおける画期的な製品になると期待しています。自動車・産業機械需要の低迷で売上高は横ばいでしたが、今後より競争力のある製品開発に注力していきます。

第二次中期経営計画(2025/4～2028/3)

TOWAは、世界において他社の追随を許さない唯一無二の企業を目指し、長期ビジョン達成のために中期経営計画を三段階に分けて遂行しています。第一次中期経営計画においては、「世界の頂」への基盤強化を主眼に置き、人員拡充や積極的な研究開発投資、生産設備への投資を通じてグループの競争力強化に努めました。第二次中期経営計画では、「新たな課題への挑戦と飛躍」をテーマに掲げ、TOWAビジョン2032の目標達成に向けた新たな課題に挑みます。



第二次中期経営計画のテーマ

第二次中期経営計画のテーマは「TOWAイズムで次世代をリードする人財を創出」です。
当社の競争力の源泉は人財であり、今後10年、20年、さらにその先も業界トップであり続けるために、人財への投資をより積極的に行ってまいります。

TOWAイズムで次世代をリードする人財を創出

TOWAの人財戦略

企業理念の継承と技術の伝承をTOWAアカデミーで

TOWAアカデミーを中心に、TOWAの根幹をなす企業理念と、培ってきた技術を次世代に伝えていきます。

未来を担うリーダーの創出

10年後、20年後のTOWAを今以上に成長させるリーダーを創出するため、人財育成、人財登用、教育など、あらゆる面から取り組んでいきます。

DX・AIで人的資本の強化

生産能力や開発能力、営業・サービス体制、管理体制などの強化にDX・AIを活用し、一人当たりの売上高、利益を高めていきます。

多様な人財の活躍環境の構築

さらなる成長に向けてイノベーションを推進するために、多様な人財がそれぞれの能力を十分に発揮できるよう、環境の構築を進めます。

第二次中期経営計画 基本方針

1	パラダイムシフトにより製品・サービスの付加価値を向上し収益力を高める	製品やサービスを提供するだけでなく、お客様に、より高い付加価値を感じていただけるように、新しい視点を取り入れたプロセス、製品、サービスなどを提供し、収益力を高めます。
2	DXとAIの活用によりスピード経営を実現し市場競争力を強化する	開発、設計、販売、サービス、管理など、あらゆる事業活動にDXとAIを活用し、変化の激しい市場環境でも迅速に対応できるスピード感を持った経営の実現を目指します。
3	コア・コンピタンス※を活用し新たな市場を創り出す	当社のコア・コンピタンスを活用し、半導体製造における他工程への進出や、全く別の分野への進出など、既存の枠組みにとらわれず、新たな収益機会を創出します。
4	多様性に富んだ挑戦思考を持ち次世代をリードする人財の育成を図る	多様な人財が活躍できる環境を構築するとともに、経営理念である挑戦思考を次世代に伝え、未来のTOWAを担う人財の育成を進めます。
5	サステナビリティへの積極的な取り組みにより社会貢献と企業価値の向上を図る	地球環境への影響や社会との繋がり、またステークホルダーの安心と健康に配慮した活動が事業活動の継続と企業の成長に重要であると考え、積極的にサステナビリティの取り組みを進めます。

※他社に真似できない核となる能力。独自の強みや専門性など

第二次中期経営計画の数値目標

(単位：億円)		2025/3月期実績	➡	2028/3月期目標	➡	「TOWAビジョン2032」 2032/3月期目標数値 売上高 1,000億円 営業利益 250億円 営業利益率 25.0%
売上高		534.7	+32.8%	710		
営業利益		88.8	+75.7%	156		
営業利益率		16.6%	+5.4pt	22.0%		
経常利益		94.0	+66.0%	156		
当期純利益		81.2	+34.2%	109		

事業別売上高目標

(単位：億円)		2025/3月期実績	➡	2028/3月期目標
売上高		534.7	+32.8%	710
半導体事業		395.3	+31.8%	521
メディカルデバイス事業		22.6	+23.7%	28
新事業		94.2	+41.1%	133
レーザ事業		22.6	+24.1%	28

より付加価値の高いプロセスや製品・サービスを提供するとともに、コスト削減や生産性を向上させ、現在よりも、一段高い利益率を目指します。
なお、長期目標である2032年3月期の売上高と営業利益に変更はありません。

「化成品事業」は「メディカルデバイス事業」へ名称を変更しました。

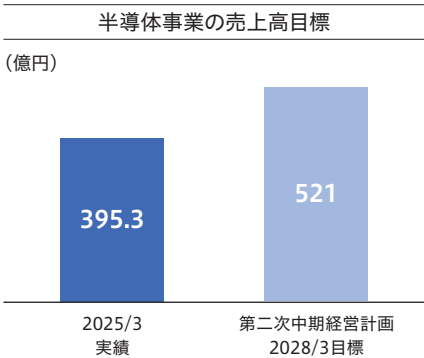
事業戦略

半導体事業

ハイエンドパッケージング工程における絶対的なトップシェアの確立に加え、MUFやレジフローコントロールなどのオンリーワンプロセスの拡販を通じて、高付加価値製品の比率を高めます。また、DX推進やAIの活用などによって生産性を向上させ、売上総利益率の改善を目指します。

- プロセスイノベーションで顧客ニーズに応える
- DXとAIの活用で世界のコストリーダーへ
- グローバルな開発体制でオンリーワン製品を世界に

収益確保に向けて	●コンプレッション比率アップ ●高付加価値製品の比率増や、AI・DX活用等により半導体事業の売上総利益率を改善
主な取り組み	●ハイエンドパッケージング工程で絶対的なトップシェアを確立 ●MUFやレジフローコントロールなどのオンリーワンプロセスを拡販 ●DXやAI、ロボットによるスマートファクトリー化

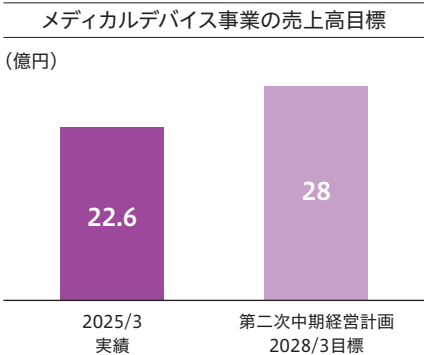


メディカルデバイス事業

強みである成形技術と組立技術を核に付加価値の高い製品の拡販を進め、利益の増大を図ります。また、メディカルデバイス企業としてのブランド構築を目指します。

- すぐれた成形技術を高度な医療機器づくりに
- 一貫生産で高収益体制に
- 技能の研鑽で価値創造ビジネスを

収益確保に向けて	「成形技術」と「組立技術」を核に高付加価値製品の拡販と利益増大を目指す
主な取り組み	●生産拠点の増強を見据えた生産体制の効率化とスマートファクトリー化の推進 ●TOWAグループのコア・コンピタンスとメディカルデバイス事業の技術を融合し次世代ビジネスを開拓 ●メディカルデバイス企業としてブランドを構築

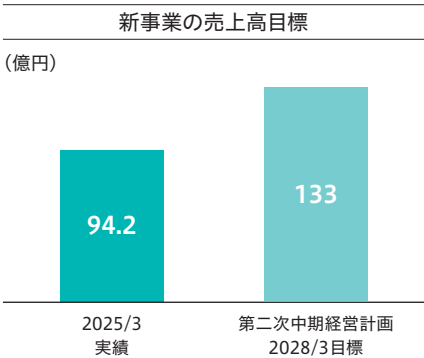


新事業

納入済み装置台数の増加によるサービス機会の拡大やリニューアルビジネスの推進などにより、売上増と利益率アップを目指します。また、工具事業が新たな収益の柱となるよう、生産体制の最適化や販売体制の強化を行います。

- コア・コンピタンスを軸に高付加価値製品で事業拡大を
- 工具メーカーとしてメジャーブランドに
- サブスクビジネスで新たな収益を築く
- リニューアルビジネスでサステナビリティを実現

収益確保に向けて	●納入済み装置台数の増加と、リニューアルビジネスの推進などによる売上拡大と利益率アップ ●工具事業を新たな柱に
主な取り組み	●3,500台超の納入済み装置への高付加価値なサポートを提供 ●リニューアルビジネスの営業エリアを拡大 ●工具事業の強化 ・スマートファクトリー化による生産の最適化 ・ラインナップの充実、グローバル販売体制の強化

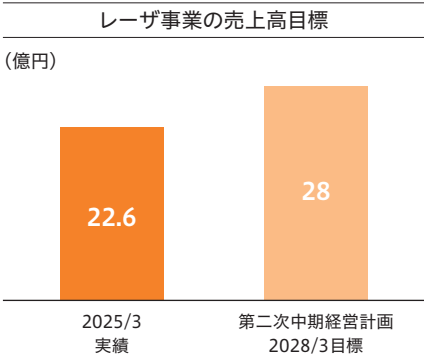


レーザ事業

競争力のある製品販売と生産コスト削減により利益率アップを目指すとともに、半導体プロセスへの応用が可能なレーザ技術を活用したプロセスおよび製品の開発を進め、事業拡大を目指します。

- 競争力のある製品で安定的な収益確保と事業拡大を
- 発振ユニット内製化とサブスクビジネスへ
- レーザ技術で半導体プロセスに一石を

収益確保に向けて	●競争力のある製品販売と生産コスト削減により利益率をアップ ●半導体プロセスに活用できるプロセス・製品を開発
主な取り組み	●次世代半導体パッケージングの実現に有効なレーザ工法を確立する ●グループ連携強化による海外営業・サポート体制の拡充と生産効率化 ●サブスクビジネスなど新たな保守サービスで付加価値を創出



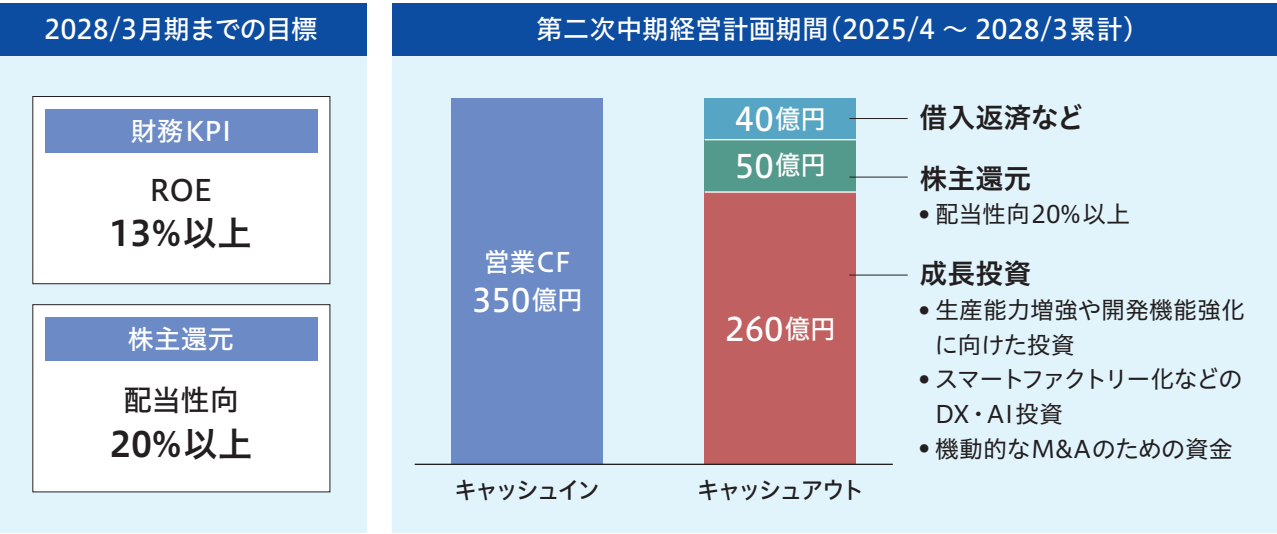
財務戦略／キャッシュアロケーション

これまで当社グループは売上高と営業利益を数値目標として掲げてきましたが、より効率的な経営を意識するため、新たにROEの目標値を設定しました。当中期経営計画期間は13%以上を目指します。

株主還元につきましては、長期ビジョン達成に向けた投資が今後も必要なことから安定配当の方針には変更はありませんが、新たに配当性向の目標値を設定しました。当中期経営計画期間は20%以上を目標としています。

また、キャッシュアロケーションも今後、開示してまいります。営業キャッシュフローの多くは、2032年の売上高1,000億円を目指すための成長投資に配分する予定です。

- 営業CFの多くは成長投資に配分
- 一方で資本効率改善も意識し、新たに「財務KPI」と「株主還元目標」を設定



サステナビリティ戦略／マテリアリティ(重要課題)

「TOWAビジョン2032」で明確にした10年後の「ありたい姿」に向けて取り組むべき課題として、マテリアリティ(重要課題)を設定しています。当中期経営計画においても、これらの課題に継続して取り組むことで、社会への価値提供を通じて、社会の持続可能性の向上を図ると同時に、企業の長期的・持続的な「稼ぐ力」の向上と更なる価値創出につなげてまいります。

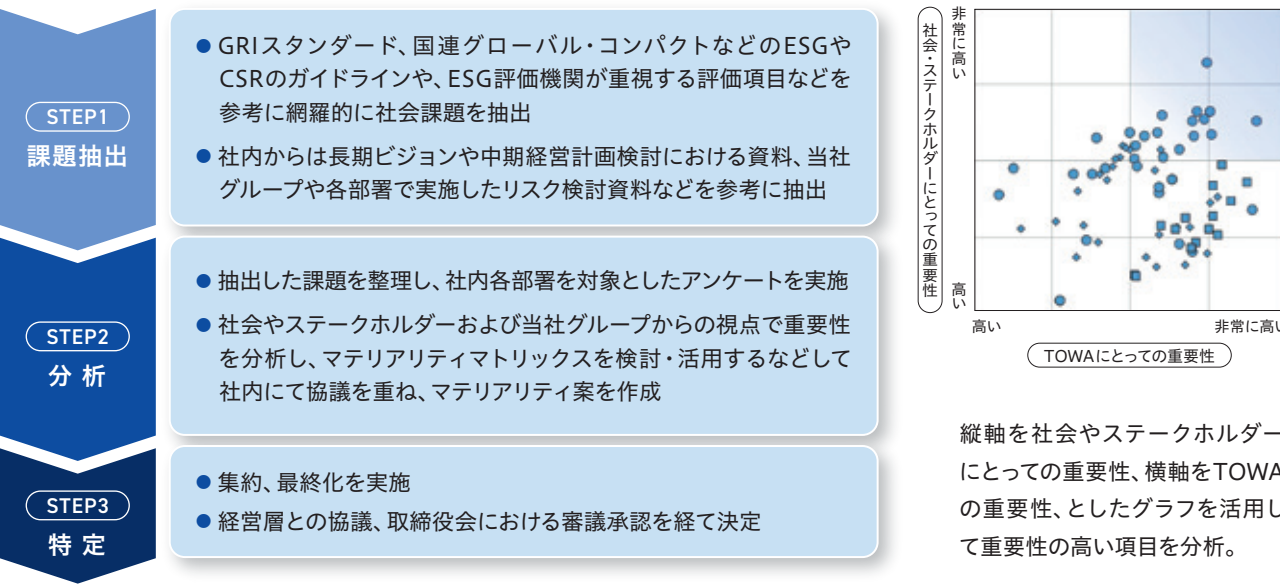


マテリアリティは、10年後のありたい姿・世界の頂に向けて取り組むべき課題、取り組み解決することで企業価値が高まる課題であることを考慮して集約し、最終化を行いました。**特定プロセス**は次のページをご参照ください。

TOWAグループのマテリアリティ

マテリアリティ	取り組みの内容	関連するSDGs
社会への貢献を通じたTOWAの価値創出	●クォーターリードに徹した「新製品・新商品・サービス」の提供による顧客の信頼と満足の向上に取り組み、価値を創出し続ける世界のリーディングカンパニーを目指します。 ●TOWAのコア・コンピタンスを基礎とした技術活用や社会課題を見据えた取り組みにより、サステナブルな社会実現への貢献を図ります。 ●取り組みは、積極的な情報発信により知名度の向上につなげます。	9 産業と雇用 12 持続可能な消費 13 気候変動 17 パートナーシップ
環境負荷低減への貢献	●自社事業におけるCO2排出量の削減に取り組み、再生可能エネルギーの導入を進め、グループ全体でカーボンニュートラルを目指します。 ●自社製品については、環境型開発を推進し、環境配慮型製品やサービスの提供を進めて、お客様の脱炭素・環境対策への貢献を図ります。また、改造ビジネス・中古機販売、TSS(Total Solution Service)を通してサーキュラーエコノミー(廃棄物の発生を抑止し製品を高い価値のまま循環させる経済活動)を推進します。 ●環境マネジメントシステムによる環境保全の取り組みを推進し、廃棄物削減、環境負荷化学物質の厳格な管理を実践します。	7 再生可能エネルギー 9 産業と雇用 12 持続可能な消費 13 気候変動
健康経営と労働安全衛生の推進	●『健(すこやか)漲(みなぎ)りて業(なりわい)壮(さかん)なり』を実践します。健康維持・増進、労働環境・安全衛生の向上、従業員エンゲージメントの強化を図り、社員が喜びとやりがいを抱いて仕事に取り組める環境を整えていきます。 ●DXによる業務効率化により働き方改革を推進します。	3 健全な生活 4 質の高い教育 8 豊かで持続可能な雇用
人財育成と多様な人財の活躍促進	●多様性に富んだ挑戦思考を持ち次世代をリードするグローバル人財の育成、変化する環境(リスク)に対応できる人財の育成を図ります。 ●ダイバーシティを尊重し、多様な人財が活躍できる環境を整え促進していきます。 ●創業以来培ってきたTOWAのコア・コンピタンス技術や企業文化を伝承していきます。	4 質の高い教育 5 性別平等 8 豊かで持続可能な雇用 10 人や国の不平等の解消
ガバナンス体制の更なる強化	●コーポレートガバナンス、コンプライアンスの取り組みを推進し、ガバナンス体制の強化を図ります。 ・リスクマネジメントの強化 ・BCP体制の強化 ・知的財産戦略の強化 ・情報セキュリティの強化 ・個人情報保護の取り組み	5 気候変動 8 豊かで持続可能な雇用 10 人や国の不平等の解消 16 平和と公正

特定プロセス



特集 戦略的技術

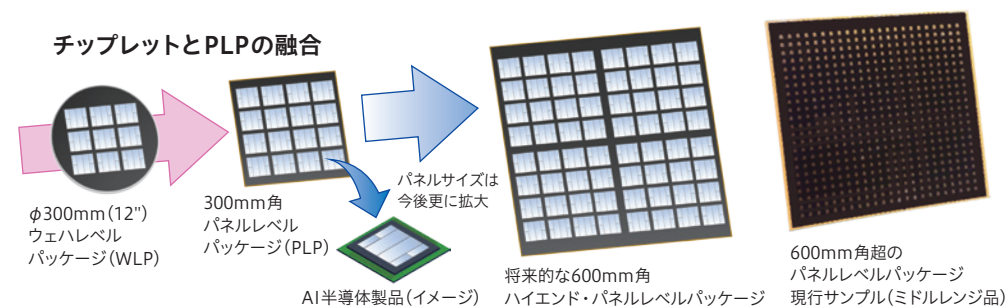
半導体パッケージングの進化に貢献

ミドル／ローエンドからハイエンドへ 大型化するAI半導体の生産性に貢献するパッケージング技術

AIの進化や社会のデジタル化が加速する中、半導体製品の高性能化が求められています。特に、生成AIを支えるGPUでは、異種チップを統合するチップレット技術が活用され、より高密度・大型化が進行しています。同時に、スマートフォンやウェアラブル端末の市場では、小型化・軽量化と生産効率向上による低コスト化が重要な要素となっています。これらのニーズに応える技術として、パネルレベルパッケージ（PLP）が注目を集めており、今後の半導体製造における重要な技術となるとされています。当社は、業界に先駆けてパネルレベルの封止技術を開発し、ラージパネルの封止を可能にする装置を提案してきました。

パネルレベルパッケージ（PLP）が先端半導体普及のカギ

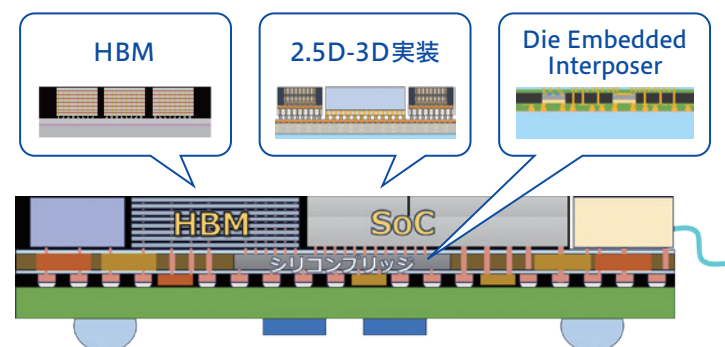
これまでPLPに関しては、ミドル／ローエンド半導体製品の低コスト化・生産効率向上を目的として基板サイズの大判化が進められてきましたが、最近では、高密度・大型化する最先端のAI半導体へも適用が進められつつあります。従来の円形シリコンウェハをキャリア基板に用いたプロセスでは、大型化する四角いインターポーザ（中間基板）の配置に無駄なスペースが生じる課題があります。PLPでは四角いキャリア基板を活用し、効率的な配置と生産性向上が実現できます。



PLPに関連する最先端トレンドと進化への貢献

先端パッケージにおいては、封止プロセスは1回だけで完結せず、複数回の封止が必要となるケースが増加しています。生成AIに不可欠なDRAMチップを積層したHBMの製造においては、コンプレッション成形による封止が行われます。さらに、SoCなどのロジックチップを実装する工程においても、WLP（ウェハレベルパッケージ）サイズで高度な真空コンプレッション成形にて2回目の封止が必要です。その後、上面研磨を経て必要に応じてチップ露出させたうえで個片化されます。この個片化プロセスには、当社はシングュレーション装置を提案しています。さらに、チップレットパッケージとして製品化するためには、基板への実装と最終封止が続きます。当社はこの工程において、トランスファ成形による基板上での露出型封止を提案しています。

今後、現在主流であるWLPからPLPへの移行が進む中で、再配線層（RDL）の進化への対応等、封止プロセスが求められるポイントはますます増加します。当社は、こうした変化に対して単一の工程ではなく全体のプロセスフローを見据えたソリューションを提案しています。当社は先端パッケージングプロセスをトータルで支える存在でありたいと考えています。



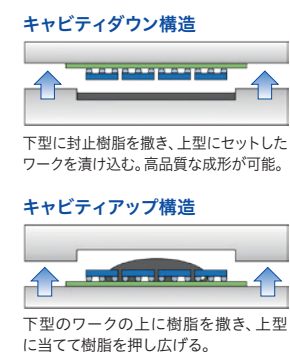
大判PLP封止における課題と当社技術

半導体封止の大判化には、技術的に難しい課題が多くあります。当社では、独自技術のコンプレッション成形を核に様々な技術でそれらに対処し、高品質なラージパネルの封止を実現しています。

キャビティダウン構造による独自コンプレッション成形

独自のキャビティダウン構造では、封止樹脂とパネルを別々に扱うことができるため、様々なメリットがあります。キャビティダウン構造では、下型に封止樹脂を均一に撒くことで、ボイドや未充填の発生を抑制できます。一方、キャビティアップ構造では、ワーク（チップを搭載した基板など）の上に直接樹脂を撒くため、ボール間などの隙間に空気が残りやすく、エアトラップが生じ、ボイドや未充填の原因となりやすい問題があります。また、クランプ時に封止樹脂が押し広げられることで、チップのずれやフローマークが発生することもあります。

さらに、キャビティダウン構造では、ワークや封止樹脂に対して均一な熱伝導性を確保できます。封止するワークは、半導体チップやパッケージ基板、封止材など多様な部材・材料で構成されており、それぞれ熱膨張率が異なります。そのため、キャビティアップ構造では、供給直後の温度が低い封止樹脂が反りなどの原因となります。キャビティダウン構造では、ワークのプリヒートも活用でき、反りや残留応力を更に軽減することが可能です。



真空技術

大型ワークを成形する金型内は大量積です。基板に数多く設置されたチップや部材の狭い隙間の空気も高度に排気し、高品質を確保しています。



チップと基板の隙間への樹脂充填（MUF）において真空引き不良により生じる欠陥（ボイド）の観察例

樹脂供給

コンプレッション成形とはいえ、不適切な樹脂供給では樹脂流動によるチップのずれやエア残留によるボイドが問題になります。また、成形厚み精度の確保にも、金型やプレス機の精度に加えて、大面積の金型に適切に樹脂を供給することが必須です。生産性を上げるためサイクルタイムの向上も行いつつ、様々なノウハウを駆使し安定した品質を実現しています。



左：不適切な樹脂供給
右：高品質な樹脂供給

その他の独自技術

他にも、独自大型プレスは大面積金型に対しても高精度を実現し、また幅広い型締め力に対応しています。オプションとして、クリーンルーム対応（クラス100対応可能）、成形厚み測定や外観検査など、お客様の様々なニーズにお応えできます。

TOWAの製品紹介

CPM1180は、660mm×620mmの超大判パネルが成形可能な業界ニーズに応えるコンプレッションモールドング装置です。またCPM1080は、HBMや2.5D/3D、チップレット、FOWLP、PLPなどの先端パッケージに対応したコンプレッションモールドング装置です。

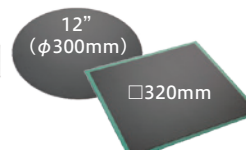
Model
CPM1180 業界ニーズに先行した
超大判成形Full-Auto機



パネル最大サイズ
660×620mm

ターゲット製品	ミドルレンジ～ハイエンドへ幅広いニーズにお応え
大判化	独自のプレス構造 大盤面でも高精度を実現
高生産性	独自樹脂供給方式などにより 高生産性に貢献

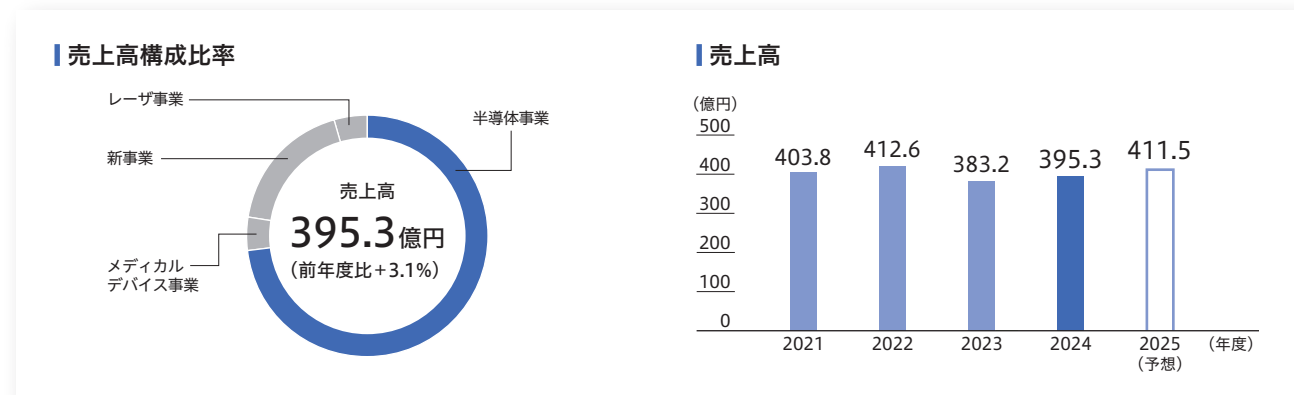
Model
CPM1080-HP WLP・PLP成形プロセスの高精度・高生産性を
実現するコンプレッションモールドング装置



ターゲット製品	HBM/2.5D/3D/Chiplet、 FOWLP/PLPなどの先端パッケージ
高品質	モールド厚み平坦度確保 高度な真空技術
高生産性	4プレスまでドッキング可能 ニーズに合わせた多様なオプション

半導体事業

常に技術革新が求められる半導体分野において、最先端技術を世界に発信し、モルディング装置のリーディングカンパニーとして進化し続けています。



事業概要

TOWAグループの主力事業で、モルディング装置(樹脂封止装置)、シンギュレーション装置、超精密金型の開発・製造を中心に行っています。

半導体チップをほこりや湿気、衝撃などの外部要因から保護する目的で樹脂によって封止するモルディング技術は、半導体の信頼性を確保するために不可欠な技術です。

当社では、半導体チップの保護を目的に、熱硬化性樹脂をゲート(供給口)からチップの周囲に供給した後に硬化させる従来型の「トランスファモルディング装置」および、顆粒等の形態で供給された熱硬化性樹脂を金型上であらかじめ加熱溶融させて半導体チップを浸した後にその樹脂を硬化させる当社独自の「コンプレッションモルディング装置」の2方式の装置を製造しています。

コンプレッションモルディング装置は、メモリや5G向けの最先端製品の半導体封止に対応しており、まさに今後のニーズに応えられる製品です。

モルディングされた製品を個片化するシンギュレーション装置では、製品を切断し収納する装置を自社開発しています。

樹脂を成形するための超精密金型は、創業時に当社が開発したモジュールシステムから進化してきたもので、数々の超精密金型を市場に供給しお客様から高い評価を得ています。



コンプレッションモルディング装置
Model PMC2030-D

2024年度の経営状況

半導体事業における経営成績は、中国地域やその他アジア地域での投資が堅調であったこと、また、装置納入台数の増加や顧客稼働率の改善による半導体製造用等精密金型の売上が増加したことなどから、売上高395億32百万円(前連結会計年度比12億7百万円、3.1%増)となりました。

半導体装置事業の強み

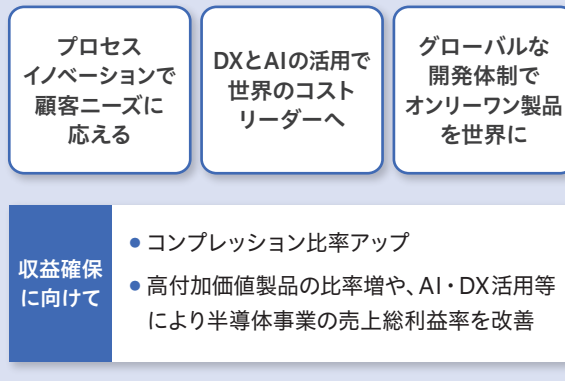
当社は、世界に先駆けてマルチプランジャでの全自動半導体樹脂封止装置を開発し、それを業界標準へと導きました。以来、他社の追随を許さないポジショニングで半導体モルディング市場におけるリーディングカンパニーであり続けています。また、内製にこだわっており、お客様のあらゆるご要望に応える体制を整えています。

グローバルに展開する当社ラボラトリでは、AI半導体向け高速メモリHBMや2.5D / 3Dパッケージング技術に最適なコンプレッションモルディング装置や、先端半導体の後工程プロセス技術であるチップレットに対応するトランスファモルディング装置などによるお客様の試作評価・共同開発を行っております。また最先端ニーズだけでなく、お客様に近い場所で、開発から供給効率化まで、幅広い開発・生産体制でご要望にお応えしています。

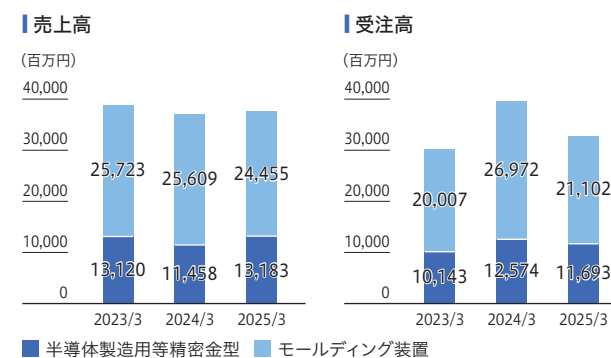


2.5D/3D/チップレット製品に最適な
トランスファモルディング装置
Model YPM1250-EPQ

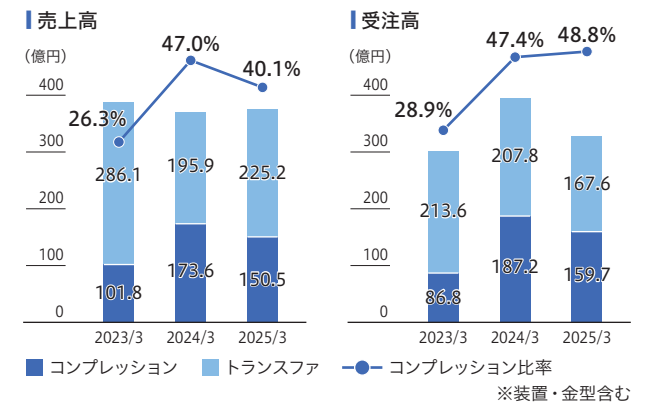
事業戦略



装置・金型の売上高・受注高の推移



コンプレッション比率の推移



Topics

インドで子会社を設立

当社は、これまでシンガポールの販売子会社を通じてインド地域のサポートを行ってまいりましたが、今後益々加速するインドの半導体関連投資に対応すべく、2025年4月にインド・グルガオン市に新たな販売子会社を設立いたしました。お客様との信頼関係を一層強固なものとするとともに、現地での事業基盤のさらなる強化を図ってまいります。将来的には、南アジアの新市場への進出を通じて、TOWAビジョン2032の実現に大きく寄与してまいります。



レーザシンギュレーションプロセスの開発

半導体の用途拡大や生産効率向上に貢献する新たなレーザシンギュレーションプロセスを開発し、このプロセスを搭載したシンギュレーション装置の販売を2025年3月に開始しました。本プロセスでは、従来を超える高速・非接触加工を実現し、高い生産性を確保するとともに、複雑で曲線的な形状の切断にも対応可能です。さらに、レーザを用いたドライ切断プロセスにより、シンギュレーション工程における水の使用量を100%削減します。その結果、お客様の工場での水使用量の削減にも大きく貢献できます。



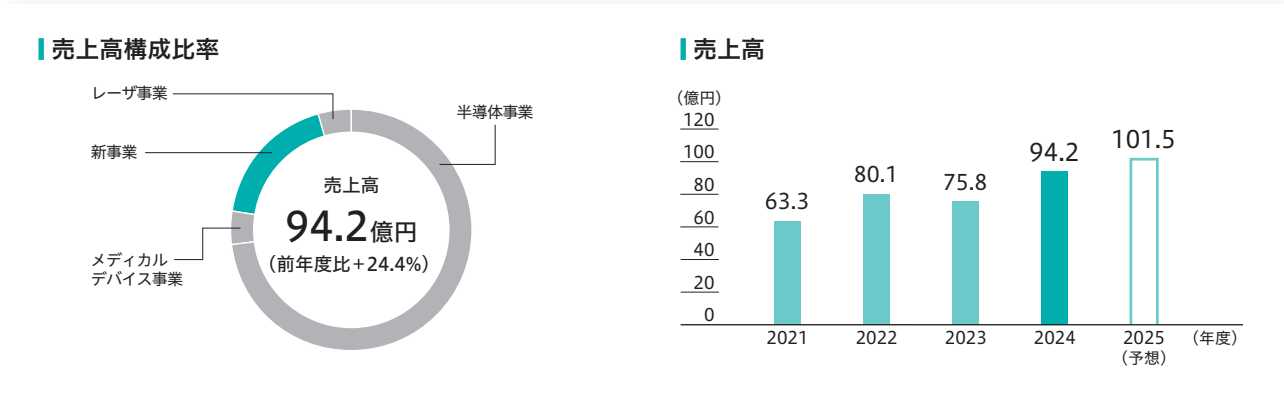
新事業

コア技術を活かし、新たな市場の創造と事業化にチャレンジしています。



医療デバイス事業

医療を中心に、さまざまな産業分野で利用されるファインプラスチックで未来に貢献します。



事業概要

半導体分野で培ってきた金型製造技術を活用して新事業を展開し、市場における新たな価値創造を目指しています。

- **TSS事業(トータル・ソリューション・サービス)**…当社半導体製造装置のアフターサービスや改造・修理、中古機の販売までトータルな提案を行っています。
- **工具事業**…金型製造メーカーのノウハウが蓄積された自社開発の工具を製造・販売しています。

- **受託事業**…TOWAオリジナルの金型表面処理技術に応用したコーティングや、超精密金型で培った超精密・微細加工技術、EF(超精密電鍍)加工技術を医療や光学部品、家庭用品などに応用・複合させた受託加工事業を展開しています。



オリジナルコーティング技術により幅広い被切削材において長寿命を実現できる超硬エンドミルシリーズ

事業戦略

コア・コンピタンスを軸に高付加価値製品で事業拡大を

サブスクビジネスで新たな収益を築く

収益確保に向けて

工具メーカーとしてメジャーブランドに

リニューアルビジネスでサステナビリティを実現

● 納入済み装置台数の増加と、リニューアルビジネスの推進などによる売上拡大と利益率アップ

● 工具事業を新たな柱に

2024年度の経営状況

新事業における経営成績は、装置の納入台数の増加や顧客工場での設備稼働率が改善したことから、半導体製造装置の部品や消耗品販売が堅調に推移しました。これにより、TSS(トータル・ソリューション・サービス)事業の売上が増加し、売上高は94億260万円(前連結会計年度比18億470万円、24.4%増)と大きく伸長しました。

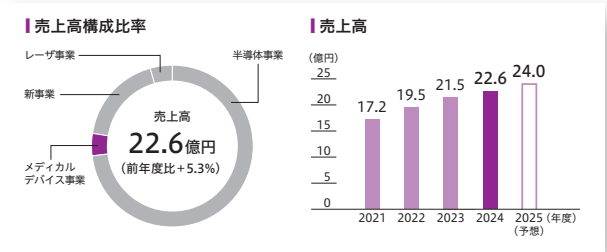
新事業の強み

超精密金型の製造技術・ノウハウ・専門能力を持った人財という独自のリソースを有することが市場において大きな強みとなっています。コーティング、ナノテク、ツーリングなどの技術は、多様な分野で利用されるため、今後も幅広い領域での戦略が望めます。当社はそれを可能にする環境や設備を自社で開発し、整備しています。

当社の切削工具は、自社開発としてお客様の様々な被削材・加工内容に対応・ご提案が可能です。コーティング開発品については、反射防止や超撥水といった機能を付加して金型用途以外への展開もすすめています。受託加工ビジネスではこれらTOWAのコア技術を応用し、様々な分野のお客様の課題解決に貢献します。



ナノレベルの加工を支える設備と環境も強みの一つ(超微細加工設備)



事業概要

医療デバイス事業では、医療、情報通信、情報家電、光学などの分野で活用されているファインプラスチックの成形を行っています。医療機器部品の射出成形および組み立てが主力となっており、1983年に化成部品部門の専門化を図るべく設立したグループ会社の株式会社バンディックで製造しています。全ての成形・組立をクリーンルームで行っており、安定して高品質な成形を実現しております。

2024年度の経営状況

医療デバイス事業における経営成績は、医療機器向けの成形品や組立品の需要が堅調であったことから、売上高22億630万円(前連結会計年度比1億130万円、5.3%増)、営業利益4億530万円(前連結会計年度比400万円、1.1%減)となりました。



電動射出成形機を40台以上所有し、全てクリーンルームで成形

事業戦略

すぐれた成形技術を高度な医療機器づくりに

一貫生産で高収益体制に

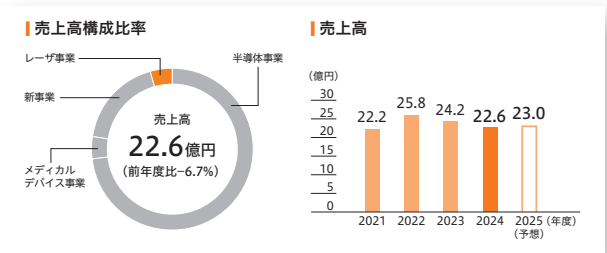
技能の研鑽で価値創造ビジネスを

収益確保に向けて

● 「成形技術」と「組立技術」を核に高付加価値製品の拡販と利益増大を目指す

レーザ事業

レーザ関連技術と半導体製造の後工程技術を融合し、新たな市場を目指します。



事業概要

グループ会社であるTOWAレーザフロンティア株式会社にてレーザトリマ、ウェハマーカ、レーザ溶接機を製造しております。今後、レーザ関連技術と半導体製造を融合させ、新たな市場を目指してまいります。

半導体ウェハに品名、ロット番号等の管理番号をレーザマーキングするウェハマーカ



2024年度の経営状況

レーザ事業における経営成績は、顧客稼働率の低迷により主力製品であるレーザトリマの売上高が低調であったことに加え、事業拡大や開発体制強化に向けた人財強化に伴う人件費の増加などにより、売上高22億560万円(前連結会計年度比1億600万円、6.7%減)、営業利益730万円(前連結会計年度比310万円、30.1%減)となりました。

事業戦略

競争力のある製品で安定的な収益確保と事業拡大を

発振ユニット内製化とサブスクビジネスへ

レーザ技術で半導体プロセスに一石を

収益確保に向けて

● 競争力のある製品販売と生産コスト削減により利益率をアップ

● 半導体プロセスに活用できるプロセス・製品を開発

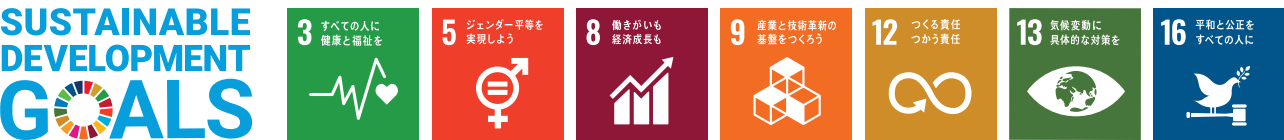
TOWA グループのサステナビリティ

サステナビリティ基本方針

私たちTOWAグループは、経営理念、行動基準、環境方針等に基づき、「クォーター・リード」の精神で産業の発展に多大な貢献を果たすとともに、お客様、株主・投資家、取引先、従業員とその家族、地域社会など、全てのステークホルダーとの強固な信頼関係を構築し、企業価値の向上と持続可能な社会の実現を目指します。

TOWAが注力するSDGs

当社は、国連が定める「持続可能な開発目標（SDGs）」における17のゴールのうち、特に事業との関連性が高い以下の項目について、重点的に貢献してまいります。



TOWAの マテリアリティ	具体的な事例		関連する SDGs 項目	ESGとの 関連
	取り組み項目	活動内容		
社会への 貢献を通じた TOWAの 価値創出	独自技術 製品の開発・ 製造・販売	樹脂効率の良い装置の開発		
		ゼロディフェクトへの取り組み		
		カスタマーエクスペリエンス（顧客体験）の取り組み		
環境負荷 低減への貢献	環境・健康 への貢献	地球環境保全への取り組み - 電気や紙など資源の使用量をモニタリングし、資源の使用量削減と業務効率化を図っています。 「グリーン調達ガイドライン」「グリーン設計規定」を定め、資材調達および設計・製造の両面で環境保全に取り組んでいます。 「化学物質管理規定」を定め、「安全データシート」に基づき、当社製品に使用される化学物質の管理を厳格に行っています。 - 国内の半導体製造装置事業で使用する全ての電力を、再生可能エネルギー由来の電力に切り替え、CO2排出量削減に取り組んでいます。 社内集約出荷や梱包材のリユースを推進し、CO2排出量や廃棄物の削減に取り組んでいます。		

TOWAの マテリアリティ	具体的な事例		関連する SDGs 項目	ESGとの 関連
	取り組み項目	活動内容		
社会への 貢献を通じた TOWAの 価値創出	環境・健康 への貢献	中古機 販売事業		
		人々の健康 への貢献	（株）バンディックでは医療機器用プラスチック成形品や、厚労省の許可を受けた高度管理医療機器を製造しています。 - 元阪神タイガース監督の矢野燿大氏による「39矢野基金」活動に賛同し、筋ジストロフィー患者や児童施設への支援を行っています。 - 社員等を対象とした献血事業への協力を行っています。	
健康経営と 労働安全衛生 の推進	健康経営			
		健康経営	「健（すこやか）漲（みなぎ）りて業（なりわい）壮（さかん）なり」をモットーとする「TOWA 健康宣言」を策定して社員の健康維持・増進に取り組んでいます。 - 社員間コミュニケーションの促進、健康・教養・趣味の向上、心身の錬磨を目的にTOWA クラブ活動・各種会社行事を行っています。 2015.12.1から従業員50名以上の全事業場に対してストレスチェックを実施しています。	
	人財 マネジメント	働き方	「TOWA 働き方改革ポリシー」を策定（2020.4.1）、社員一人ひとりの健康と働きがいを第一に考え、働き方改革を重要な経営課題の1つとしました。 産休・育休後の職場復帰支援を推進しています。 ワークライフバランスの醸成を支援。有給休暇取得を奨励する「クリエイティブ・ホリデー」制度の運用を推進しています。	
ガバナンス 体制の 更なる強化	人財育成と 多様な人財の 活躍推進	人財育成	｜自己啓発・資格取得・各種表彰制度｜ - 全社員を対象に毎年2回の通信教育受講を奨励し、自己啓発活動を支援しています。 - 社員へのTOEICとHSK受験を奨励しています。年間1回の受験費用については会社が全額負担しています。 - 勤続や貢献に応じた表彰ほか、「チャレンジ賞」「グローバルTOWA賞」を設けています。	
		コンプライアンス	- コンプライアンス教育、輸出管理教育、ハラスメント研修、環境教育ほか社内教育を実施しています。 - 専用メールアドレス（女性社員専用あり）を設けて内部通報制度を整え、調査委員会が調査を行います。 「人権方針」「腐敗防止方針」に基づき、適切な事業活動に努めてまいります。	
ガバナンス 体制の 更なる強化	国際社会の 一員としての 責任の遂行	コーポレート ガバナンス	コーポレートガバナンス・コードに沿った経営を実践し、他社の状況や議決権行使助言会社の方針等を踏まえて、より実効的なガバナンス体制を模索しています。	
		リスク マネジメント	社内リスク管理の最高機関として、社長を議長とする「リスク管理委員会」を設け、定期的に対処すべきリスク抽出や評価を実施しています。	

E TOWA グループの環境への取り組み

基本的な考え方

TOWAグループは、持続可能な循環型社会を実現するために、各事業所において環境マネジメントシステムを構築し、グループの事業活動に起因する環境負荷の低減に努めています。

製品開発においても、環境負荷の低減に配慮した設計・開発をテーマに、製品の環境性能向上に努めています。

環境方針

TOWA 株式会社は、「地球環境の保全」が人類共通の重要課題であると認識し、事業活動を通じて、環境に配慮した「技術開発」により、「新製品・新商品・サービス」を市場へ供給し、地球環境負荷軽減に貢献します。

- 1.当社は、事業活動および製品やサービスが地球環境に与える影響やその要因を把握し、地球環境汚染の予防、地球温暖化対策に努めます。
- 2.当社は、事業活動および製品やサービスに関わる環境関連の諸法令・規制を順守します。
- 3.当社は、事業活動および製品やサービスにおいて、次の事項を重点テーマとして取り組みます。
 - (1) ライフサイクルを考慮した、環境負荷の少ないグリーン設計の推進
 - (2) サプライチェーンへの働きかけによる、環境負荷の少ないグリーン調達
 - (3) 環境負荷化学物質の厳格な管理
 - (4) 事業活動における省エネ・省資源への取り組み継続
- 4.当社は、「環境方針」を達成するために、戦略目標を定め、具体的に実現するための手段を策定し、その成果を定量的に測定する指標を定め、継続的改善に取り組みます。

2025年4月1日
TOWA 株式会社 取締役社長執行役員 三浦宗男

気候変動対策 脱炭素の取り組み

当社グループは、気候変動の原因とされる温室効果ガスの排出量削減を重要な課題と捉え、CO₂排出量削減目標を策定し、グループ全体でカーボンニュートラルを目指して取り組んでいます。2021年度より気候変動対策に本格的に着手し、生産拠点へのソーラーパネル導入や電力会社が提供する再生可能エネルギープランへの切り替えなどを積極的に実施してまいりました。

2024年度のグループ全体のCO₂排出量（Scope1+2）は、本格的な気候変動対策に着手した当初に計画した施策が一段落したことや、売上高増加の影響を受け前年度よりわずかに増加し（+459t）、13,163tとなりました。

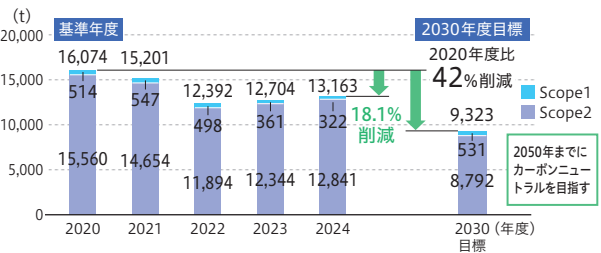
今後も更なる再エネ活用の推進や既存施策の継続などにより、CO₂排出量削減の取り組みを進めてまいります。

TOWAグループのCO₂排出量削減目標

- 2030年度において自社（Scope1+2）のCO₂排出量を2020年度比42%削減します。
- 2050年までに実質ゼロ（カーボンニュートラル）を目指します。

Scope1：自社による温室効果ガスの直接排出
Scope2：他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

CO₂排出量実績と目標



TCFDの枠組みに基づく情報開示の取り組み

当社グループは「気候変動」を重要な経営課題の一つとして認識し、2022年5月にTCFD※の提言に賛同を表明しました。提言内容に沿って、気候変動に関連するガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の項目について開示しています。ガバナンスでは環境経営の推進体制を整え、取締役会で気候変動に関する基本方針等の審議・決定、リスク管理を実施しております。

※「気候変動関連財務情報開示タスクフォース（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）」の略称。TCFD提言は企業等に対し、気候変動関連情報の開示を推奨している。



TOWAの描く各シナリオの世界観

戦略の検討においては、評価対象を半導体関連製品を含むサプライチェーン全体として将来の気候変動が当社事業へもたらすリスク・機会を整理し、1.5℃シナリオを含むシナリオ分析を定性的・定量的に実施することにより当該リスク・機会の影響を評価しております。シナリオ分析については、今後の環境の変化を踏まえ、定期的にレビューしていきます。

リスク管理については、社長を議長とする「リスク管理委員会」を設け、定期的に対処すべきリスクの抽出や評価を実施しています。指標と目標については、環境目標の中で「CO₂排出量の削減」を目標として設定しCO₂排出量の削減に取り組んでおり、その中でScope1、2に関するCO₂排出量の測定・開示を行い、活動実績を公表してまいります。

気候変動リスクの低減に向け、TCFDの枠組みに基づき、ガバナンスを強化し、リスク・機会の抽出や財務的影響の把握を通じて対応を推進するとともに、さらなる情報開示の充実を図ってまいります。

詳細につきましては、下記「TCFD 提言に基づく開示」のウェブサイトをご参照ください。

<https://www.towajapan.co.jp/jp/company/environment/#TCFD>

設定したシナリオの概要

	設定シナリオ	
	1.5℃シナリオ	現行シナリオ（現状維持シナリオ）
想定される事業環境	リスク 1.5℃の世界の実現に向け、全世界で炭素税の導入が進み、2030年で先進国では130\$/t-CO₂を超える水準に。 - 顧客の環境意識が高まり、製造装置の省エネ・省CO₂化が厳格に求められるようになる。ただし、省エネ技術開発は大きく進展する。 機会 - EV販売台数の伸長や再エネ機器の普及、また顧客の国際イニシアティブ（RE100、SBT等）の達成ニーズの高まりに伴い、半導体製造装置の需要は現状よりも大きく拡大。 - 経済性に加え、サーキュラーエコノミーの概念の普及に伴い製造装置の中古市場は現状よりも大きく拡大。	リスク - 台風被害の増加、洪水頻度の増加等激甚災害の頻度増加に伴い、自社工場・サプライチェーン拠点の被災リスクが高まる。 機会 - EV販売台数の伸長や再エネ機器の普及、また顧客の国際イニシアティブ（RE100、SBT等）の達成ニーズの高まりに伴い、半導体製造装置の需要は拡大傾向も1.5℃シナリオに比べると伸びは緩やかとなる。 - 経済性の観点から製造装置の中古市場は拡大傾向も1.5℃シナリオに比べると伸びは緩やかとなる。
シナリオ参照	- IEA:WEO2021 NZEおよびSDS - IPCC 第6次評価報告書 第1作業部会報告書：SSP1-1.9, SSP1-2.6	- IEA:WEO2021 STEPS - IPCC 第6次評価報告書 第1作業部会報告書：SSP3-7.0, SSP5-8.5

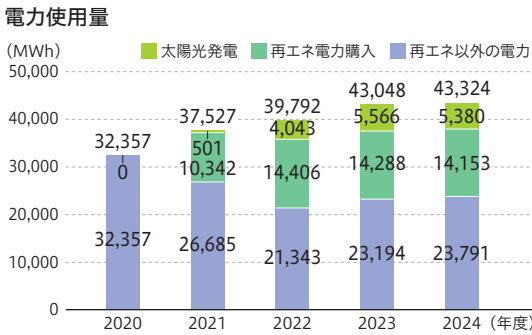
TOWAグループの環境への取り組み

CO2排出量算定と削減の取り組み

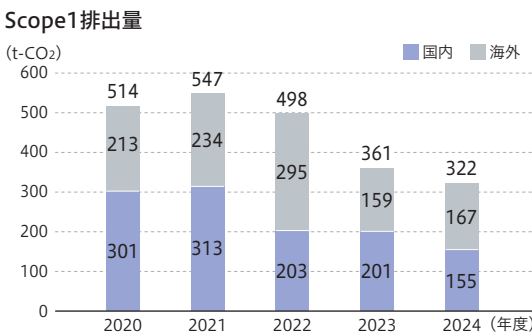
Scope1, 2の取り組み

TOWAグループでは、自社で使用する電力について、再生可能エネルギー由来への転換を積極的に推進しています。2022年1月より創エネとして太陽光パネルの導入を進めており、発電した電力を各工場において活用しています。2024年度の発電量は5,380MWhであり、これはCO₂に換算すると約3,200tの排出量削減に相当します。さらに、国内の主要事業所(本社・工場、京都東事業所、九州事業所)では、2021年7月より電力会社が提供する再生可能エネルギー由来の電力メニューへの切り替えを継続しています。こうした取り組みにより、2024年度は、当社グループの生産拠点において、全使用電力に占める再生可能エネルギー由来電力の比率(再エネ比率)は45.1%となっています。今後もグループ全体で再生可能エネルギーの活用拡大に努めてまいります。

また、燃料の使用などに起因するScope1のCO₂排出についても削減を推進しています。近年の主な施策としては、都市ガスを利用していた空調設備を、エネルギー効率の高い電気式へ更新しました(本社・工場：2022年4月、TOWA韓国：2023年10月)。さらに、社用車についても、燃費性能に優れたハイブリッド車や電気自動車(EV)への置き換えを進めており、2022年には本社・工場にてEVを2台導入しました。こうした取り組みにより、グループ全体のScope1排出量は2022年度以降、大きく削減が進みました。Scope1においても、引き続きCO₂排出量の削減に取り組んでまいります。



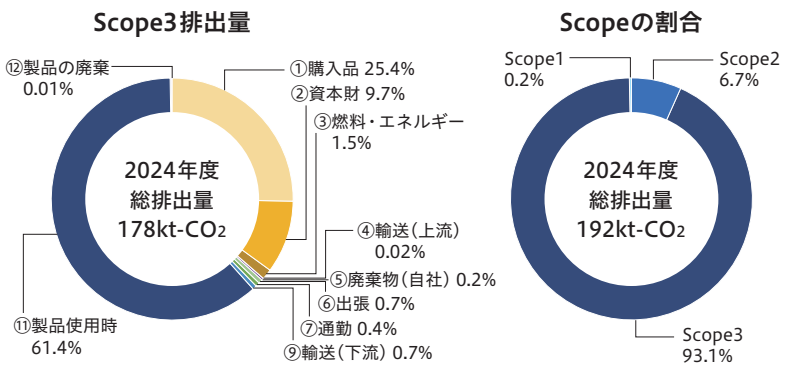
太陽光パネル導入の事例



Scope3排出量の算定

Scope1および2、すなわち燃料や電気の直接使用に関わる範囲のCO₂排出量削減の取り組みに加えて、企業活動全体に取り組みを広げるために、2022年度実績より当社グループのScope3排出量の算定を開始しました。Scope3排出量は、購入品の製造や従業員の出張といった企業活動の上流から、販売した製品の輸送、お客様使用時の電力消費、製品の廃棄といった下流にわたる広くサプライチェーン上の企業活動に伴うCO₂排出量を算定したものです。

今後は、排出量の多いカテゴリである製品使用時の排出を中心に算定精度の向上を図るとともに削減貢献量も考慮し、製品の省エネ化や廃棄物削減などを通じて、お客様をはじめ社会全体への貢献をさらに推進してまいります。



2024年度のScope3排出量実績

カテゴリ名	排出量実績 (千t-CO ₂)	算定範囲	算定方法
Scope3合計	178.42	—	—
1. 購入した製品・サービス	45.38	※1	購入金額に排出原単位を乗じて算出。
2. 資本財	17.34	※2	設備投資額に業種ごとの排出原単位を乗じて算出。
3. 燃料・エネルギー関連	2.66	※1	エネルギー購入量に排出原単位を乗じて算出。
4. 輸送、配送(上流)	0.04	※1	製品の生産拠点国内における輸送について、輸送重量×距離に排出原単位を乗じて算出。なお、購入した製品・サービスに関する輸送はカテゴリ1で算出。
5. 事業から出る廃棄物	0.34	※1	廃棄物排出量に廃棄物輸送段階を含む廃棄物種類別の排出原単位を乗じて算出。
6. 出張	1.17	※1	単体は交通費支給額に交通手段別排出原単位を乗じて算出。グループ会社は従業員数に排出原単位を乗じて算出。
7. 雇用者の通勤	0.68	※1	従業員数、営業日数に都市区分ごとの排出原単位を乗じて算出。
8. リース資産(上流)			Scope1、2にて算出。
9. 輸送、配送(下流)	1.22	※3	カテゴリ4を除く製品の輸送について、輸送重量×距離に排出原単位を乗じて算出。
11. 販売した製品の使用	109.57	※3	販売した製品種類ごとの年間消費電力と製品寿命を推計・設定し、CO ₂ 排出係数を乗じて算出。
12. 販売した製品の廃棄	0.02	※3	販売した製品の重量に廃棄物種類・処理方法別の排出原単位を乗じて算出。

10. 販売した製品の加工、13. リース資産(下流)、14. フランチャイズ、15. 投資は、対象となる活動などが無いため対象外とした。
※1 主要生産拠点 国内：本社・工場、京都東事業所、九州事業所、バンディック、TOWA レーザーフロント
海外：TOWA 韓国、TOWAM、TOWA 半導体設備(蘇州)有限公司、東和半導体設備(南通)有限公司、TOWA ファイン、TOWA TOOL
※2 連結
※3 半導体事業およびレーザ事業において販売した製品

使用した排出係数やScope1,2の情報などはこちらからご覧ください。 <https://www.towajapan.co.jp/jp/company/esgdata/>

活動内容・取り組み事例

■ グリーン調達、グリーン設計、グリーン購入の取り組み

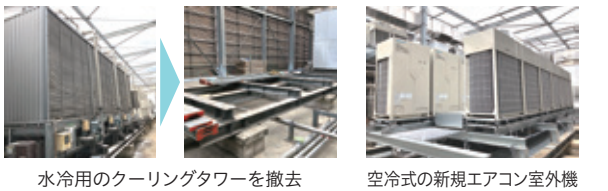
当社は環境マネジメントシステム(EMS)認証の一環として、「グリーン調達ガイドライン」および「グリーン設計規定」を定め、資材調達および設計・製造の両面においてRoHS 指令規制物質への対応や環境負荷物質の低減に取り組んでいます。また、製品に関わるサプライヤーや環境側面に大きく関わる業務委託先等には重要度ランクに応じて当社の環境方針、各種手順書、グリーン調達ガイドラインを配布して遵守をお願いし、サプライチェーンを通じての環境保全に取り組んでいます。これからも環境に配慮した当社製品の設計・開発に努めてまいります。

■ サステナビリティ・リンク・ローンの活用

当社は、2022年に株式会社京都銀行とサステナビリティ・リンク・ローンの融資契約を締結し(融資額12億円、融資期間5年)、「TOWAビジョン2032」の成長戦略における投資等に活用しています。2024年度につきましても、「サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(SPT)」をクリアし、設定されたインセンティブを獲得することができました。

■ 本社・工場の空調設備更新

本社・工場では、2022年4月に都市ガスを使用していた空調設備を電気式に更新し、電力会社の再エネメニューを活用することにより、都市ガス使用に伴うCO₂排出量の削減が可能となりました。2024年度は、工場や会議室等で使用している経年劣化したパッケージエアコン82台(室外機17台)を更新しました。エネルギー効率の高い設備への更新により、従来と比較し約3割の節電が見込まれます。さらに、従来は水冷式でしたが、空冷式とすることで年間700~800トンの節水も見込んでいます。また、これらの空調設備には、オゾン層を破壊する成分を含むR22(HCFC)冷媒が使用されていたことから、法令に従い適切に回収と手続きを実施しました。今後も設備機器単位での省エネにも積極的に取り組んでまいります。



S TOWA グループの社会への取り組み

基本的な考え方

ものづくりや製品開発における品質向上や安全安心だけでなく、全ての従業員とその家族の健康と幸せを追求するため、多様な個性を尊重した働き方を推進します。また、SDGsの考え方に基づき、地域の安全や健康増進、活性化のために社会的責任を果たします。

人的資本への取り組み

TOWAは「社員＝財産」と考えており、社員一人ひとりの健康と働きがい第一とし、人財育成や健康経営の推進に取り組んでいます。人財の多様性の確保を含む人財育成に関する基本方針と社内環境整備に関する方針を次のように定めて中長期的な企業価値向上に努めています。

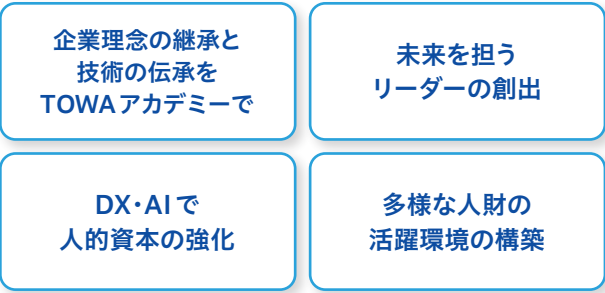
人財育成の基本方針

TOWAは、『“挑戦”し続ける』行動により『“変革”をもたらす』企業文化を次世代へ継承していくことが、企業発展の源泉と考えています。多様な人財それぞれの挑戦に対する支援が、企業の成長に繋がり、社員自らが学ぶ文化が醸成され、自律的に成長可能な組織が実現すると考えています。

このように、TOWAでは、『創業者イズムを継承し、絶えず挑戦し続け、変革をもたらす人財』を輩出し続けることを目指しています。

人財育成の戦略について

第二次中期経営計画では、「TOWAイズムで次世代をリードする人財を創出」をテーマとして人財の取り組みに注力します。当社の競争力の源泉は人財であり、今後10年、20年、さらにその先も業界トップであり続けるために、人財への投資をより積極的に行ってまいります。



社内環境整備方針

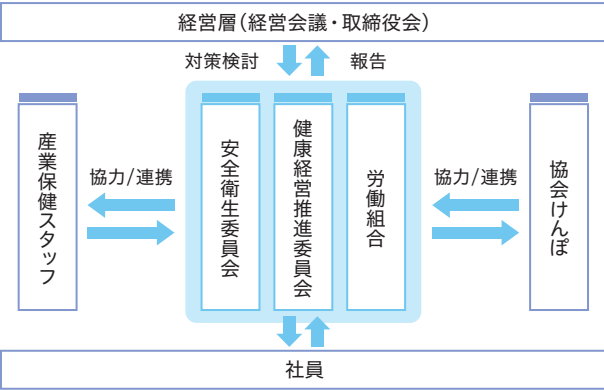
『健(すこやか) 漲(みなぎ) りて業(なりわい) 壮(さかん) なり』

私たちTOWAは、『健康』であれば心身共に『漲る』ものが生まれ出し、『社業』も栄える事を念頭に、社員全員の健康維持・増進、笑顔溢れる職場環境作りに取り組んでいます。

また、TOWA社員が心身ともに健やかに働ける環境を整えることは、社員やその家族に健康と幸福をもたらし、明るい社会づくりへ繋がると考え、環境整備に取り組んでいます。

健康経営推進体制図

当社では、経営会議・取締役会での検討のもと、健康経営推進組織を中心に、産業保健スタッフや安全衛生委員会、労働組合などと連携し、社員の健康保持・増進に取り組んでいます。



基本方針に関する指標および目標

当社は、人的資本への取り組み推進のための指標と目標を次のように設定しています。

指標	目標	実績 (当連結会計年度)
中途採用者管理職比率	35.0%※6	36.0%
外国人管理職比率	10.0%※6	4.5%
女性管理職比率	10.0%※6	3.4%
プレゼンティーズム損失率※1	22.8%※7	25.0%
アブセンティーズム※2	2.1日※7	3.3日
ワークエンゲージメント※3	2.52※7	2.49
いきいき度※4	110※7	105
健康総合リスク※5	85※7	91

表はTOWA単体のみの指標、目標および実績値です。

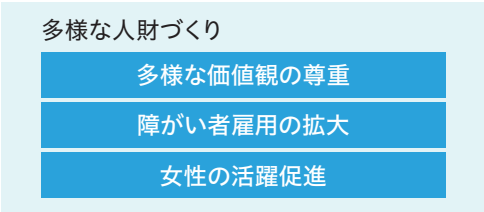
※1 出勤しているにも関わらず、心身の健康問題によりパフォーマンスが低下したことによる損失率
※2 心身の健康問題により仕事を欠勤（休職）している状態
※3 仕事をしていると活力がみなぎり、自身の仕事に誇りを感じる状態（最大値:5）
※4 職場の一体感と個人のワークエンゲージメントを総合的に見た値（数値が大きいほど良い状態）
※5 職場のストレスが個人の健康に与えるリスクの程度を示したスコア（数値が小さいほど良い状態）
※6 2032年3月まで
※7 2028年3月まで

人権方針

TOWAグループは、自らの事業活動において、影響を受けるすべての人々の人権が尊重されなければならないことについて理解を深め、策定した人権方針に基づき、適切に活動してまいります。人権方針につきましてはこちらのウェブサイトをご参照ください。 <https://www.towajapan.co.jp/jp/company/humanrights/>

DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)

当社では、年齢・国籍・性別・障がいの有無などの「属性」のダイバーシティに加え、目に見えにくい価値観・経験などで生まれる「視点・思考」を含めたダイバーシティを尊重し、それらを「強み」に変えるグループ全体での仕組みや風土づくりを進めています。



人的資本に関する取り組み事例

TOWAイズム継承の取り組み

TOWAアカデミーでは、昨年より「TIK(TOWA-ism Keisho) ミーティング」を実施しています。自分自身が働く上で「大事にしている考え方や行動」を振り返り、TOWAにおける企業理念との接点、共感部分について部署ごとにディスカッションを行うものです。将来にわたり“挑戦し続ける文化の醸成”と“挑戦により変革をもたらす人財の創出”に向けた取り組みを展開していく予定です。

社内表彰・褒章制度

勤続年数に応じた勤続表彰や、業績への貢献などに応じた表彰があります。挑戦を称える「チャレンジ賞」、世界の関係会社に授与する「グローバルTOWA賞」も設けています。

研修・教育

eラーニングを活用し、コンプライアンス教育、輸出管理教育、メンタルヘルス教育、ラインケア研修（対象は管理職）、情報セキュリティ教育、社会人基礎教育（DX

基礎等）、法務教育、品質・環境マネジメント自覚教育、SDGs・ESG教育などの各種教育を実施。

株式給付信託(J-ESOP)の導入

長期ビジョンの実現に向け従業員には高い次元での挑戦が求められます。その成果に報いる観点からインセンティブプランとして2023年に本制度を導入しました。従業員自身が株主となることで、企業価値向上に伴う株価向上が従業員の財産形成に繋がります。今後の従業員のエンゲージメント向上に寄与し、当社の持続的な成長に資すると考えています。

定年再雇用制度

2022年3月より、定年以降も定年前と同水準の給与で処遇する再雇用制度を導入し運用しています。従業員が定年後も自立した生活を維持しやすくなり、仕事で活躍することで自己表現や成長できる機会が増すとともに、ノウハウや企業文化の若手社員への伝承促進が期待されます。

S TOWAグループの社会への取り組み

活動内容・取り組み例

スマートな働き方の推進

TOWA働き方改革ポリシー

社員の価値観やライフスタイルを尊重しサポートすることを目的に、「TOWA 働き方改革ポリシー」を策定しています。当社は、「社員＝財産」と捉えて社員一人ひとりの健康と働きがいを第一に考え、働き方改革を重要な経営課題のひとつとして位置づけています。社員の主体性を大切にしたい同ポリシーは、個々の社員が自身および周囲の働き方を考えることで就業環境の整備や自己成長のチャンスを掴もうとする「自ら変えていく力」を応援しています。

ライフスタイルに応じて活用できる、産休・育休後の職場復帰支援制度

社員が出産や育児をしながらいきいきと仕事を続けていけることが社員の健康、働きがいにつながるものであるととらえる、ライフスタイルに応じて柔軟に活用できる制度づくりと理解ある職場の環境づくりを心掛けています。

今後もより多くの社員が安心して産休・育休を取得でき、会社に復帰した際に社員が働きやすいと感じる温かい環境づくりを推進してまいります。

仕事との両立サポート	
育児休職	介護休職
看護	復職
など	

TOWAの両立支援行動計画について

当社は、「次世代育成支援対策推進法」ならびに「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、当社の両立支援行動計画を策定し、厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」および「女性の活躍推進企業データベース」で行動計画等を公表しています。各計画において、社員への情報提供、実施における課題検討、管理職への研修などを行って施策を推進してまいります。各計画の内容につきましては、厚生労働省の次のサイトをご参照ください。

■ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
「両立支援総合サイト」  <https://ryouritsu.mhlw.go.jp/>

■ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく行動計画
「女性の活躍推進企業データベース」  <https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/>

Topics

外部評価

健康経営に関する外部評価として、「健康経営優良法人2025（大規模法人部門）」（4年連続）、「スポーツエールカンパニー2025」（3年連続）ならびに「きょうと健康づくり実践企業」に認定されました。なお、健康経営優良法人につきましては、TOWATEC株式会社（中小規模法人部門／3年連続）、TOWAレーザーフロント株式会社（中小規模法人部門／6年連続）も認定をいただいています。

また、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づき、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良な企業として、厚生労働省より「えるぼし」の2段階目の認定を受けました。



健康経営の推進

当社では、健康経営推進の一環として、社員が喜びとやりがいを抱いて仕事に取り組める環境づくりに取り組んでいます。社員一人ひとりの健康保持・増進、ワーク・ライフ・バランスの向上と、安全にいきいきと働くことができる職場環境づくりに取り組み、健康経営を推進してまいります。

■ TOWA健康宣言

「健（すこやか）漲（みなぎ）りて業（なり）わい）壮（さかん）なり」を掲げる健康宣言を策定し、社員全員の健康維持・増進に取り組んでいます。笑顔あふれる職場づくりで社員・家族の健康を目指します。



■ TOWAクラブ活動・各種会社行事

社員が立ち上げた運動・文化系のクラブ活動に多くの社員が参加しています。活動費の一部を会社が補助することで、個人の負担を軽減し、活動を支援しています。社員の家族が参加できるイベントも開催しています。



11月、京都東事業所多目的グラウンドにてスポーツフェスティバルを開催しました。雲一つ無い絶好の晴天に恵まれ、社員、家族一体型のイベントとしてスポーツを通して交流を深めました。

■ ヘルスケアルームの設置

社員の健康推進と福利厚生を目的としてヘルスキーパー（企業内理療師）を設置しています。理療の国家資格を持ったヘルスキーパーが理療の施術やセルフケア指導、健康への助言などを行っています。またヘルスケアルームから社員に向けた情報発信や、利用しやすい環境整備にも力を入れています。



施術、セルフケア指導の様子

■ メンタルヘルスに関連した研修

メンタルヘルスの専門家のご協力を得て「セルフケア研修」を開催しました。セルフケアの重要性や心の健康を保つ基本について学びました。



ラインケア研修の様子

また、管理職を対象とした「ラインケア研修」も開催しました。2回に分け、講義と面談の実習を含むグループワークで、実践的な講習となっています。

■ メンタルヘルス支援の「相談窓口」

社員の健康保持・増進と会社の生産性向上を目指す取り組みの一つとして、社外カウンセラーによる「相談窓口」を設けています。仕事やキャリア、メンタルヘルスに関する悩みを気軽に相談できる環境を整え、こころのケアをサポートします。また、カウンセリング体験会を開催し、多くの社員がこの支援を活用できるよう取り組んでいます。

■ がん検診費用補助

従業員の健康増進をサポートするためには、がんの早期発見・早期治療が重要であると認識しています。女性に多い病気や、配慮すべき健康リスクなどについて、全社員を対象とした「女性の健康講座」を開催するなど、がんについての正確な情報提供の場を増やしています。さらに、国が推奨する5つのがん検診については、費用を全額当社が負担し、検診受診率のアップに努めています。

■ 「がん対策推進企業アクション」推進パートナー

「がん対策推進企業アクション」推進パートナー企業として登録されました。また、健康経営に関する取り組みを広げるため、当社は企業の女性のがん対策を牽引するプロジェクト「Working RIBBON」に参画しています。



■ 第11回 きょうと健康づくり実践企業表彰

「きょうと健康づくり実践企業」は社員のがん検診受診率向上や健康づくりに取り組む企業を、京都府が認証するもので、令和5年度より継続認証を受けています。特に取り組みの優れた事業所が毎年表彰されており、11月21日開催のヘルス博 KYOTO 2024で「優秀賞」をいただきました。



ヘルス博 KYOTO 2024・授賞式

健康経営への取り組みはこちらからご参照ください。  <https://www.towajapan.co.jp/jp/company/health/>

S TOWAグループの社会への取り組み

安心・安全な商品をつくり、届ける

信頼と満足のために追求する最高の品質

ものづくりを事業活動の根幹とする当社は、設計、製造、検査および納品後のアフターサービスまで、すべての工程において一貫した品質を保証するプロセスの構築と改善に取り組んでいます。同時に、最新システムやAIの導入などを通してサービスや業務の質の向上を図っています。

また、品質方針を策定し、これを達成するために、戦略目標を定め、具体的な実現手段を策定し、その成果を定量的に測定する指標を定め、継続的改善に取り組んでいます。

世界の半導体装置市場に製品を供給する当社では、グローバル化に対応した国際的な技術水準での品質保証活動を展開するため、早くから品質保証体制の確立に取り組み、品質保証の国際規格であるISO9001の認証取得を推進してきました。グループの生産拠点においては、ISO9001を株式会社バンディックを除き認証取得しております。なお、医療機器の成形と組立受託製造事業を展開するバンディックでは、医療機器・品質マネジメントシステムのISO13485を認証取得しております。



最新技術と高品質の製品を生み出す設備と環境



ISO9001認証
(品質)

(坂東記念研究所、INNOMS推進室を除く)



ISO14001認証
(環境)

Topics カスタマーリレーションの取り組み

テキサス・インスツルメンツ社様より 「2024 Texas Instruments Supplier Excellence Award」を受賞

当社は、テキサス・インスツルメンツ社様(Texas Instruments Incorporated、米国テキサス州ダラス)より「2024 Texas Instruments Supplier Excellence Award」を受賞いたしました。

本賞は、テキサス・インスツルメンツ社様が、技術革新、協業活動、ならびにパフォーマンスにおいて高い基準を一貫して達成し続けたサプライヤーを表彰するものです。技術革新と協業活動に対して並外れた取り組みを示し、コスト、環境・社会的責任、技術力、サービス対応、供給保証、品質の各分野において優れたパフォーマンスを発揮したことを評価され、今回、全世界の1万社を超えるサプライヤーの中から選ばれた19社のうちの1社として表彰されました。今後ともお客様の生産性向上やトータルコストの削減に貢献するオンリーワンのプロセスや、製品・サービスを提供してまいります。



カスタマーエクスペリエンス向上の取り組み

当社では、お客様のニーズを迅速かつ正確に把握し、顧客満足度の向上につなげるため、商品やサービスの購入時だけでなく、購入までの過程、使用時、そして購入後のサポートに至るまで、お客様の体験価値を高めることを目的としたカスタマーエクスペリエンス(顧客体験)に着目した取り組みを推進しています。

2024年の取り組みとしては、1月に実施した定期調査の結果をもとに4つの優先課題を設定し、4月からプロジェクトを始動しました。11月には中間報告会を開催し、各チームの進捗報告や今後のスケジュールの共有、質疑応答を通じて、共通の目標に向けた取り組みを再確認しました。本プロジェクトには、2024年度時点で約60名が参加しています。今後はより部門横断型として連携を強化し、すべてのチームが共通の目標であるNPS(顧客推奨度の指標)と顧客満足度の向上を目指して活動に取り組んでまいります。また、この取り組みは、従業員のやりがい・働きがい(従業員エクスペリエンス)の向上にも繋がると期待しています。



11月に開催した中間報告会の様子

社会貢献活動／コミュニティ・行事への参加

社内献血の実施

毎年春季と夏季の2回、社員等を対象とした献血事業への協力を継続しています。当社の長年にわたる献血事業への理解と協力に対し、日本赤十字社から、「銀色有功章」と「金色有功章」を授与されました。これからも輸血を必要とする世界中の人々を支えていくために、日本赤十字社と協力し、積極的に献血活動の普及、啓発に取り組んでまいります。



日本赤十字社の「金色有功章」

“京都「志」奨学金”制度への賛同

当社は、公益財団法人 京都オムロン地域協力基金が運営する奨学金制度“京都「志」奨学金”に賛同し、2025年度の給付分より賛助会員として支援を開始しました。この奨学金制度は、京都府にゆかりがあり、自らの将来に対して強い志を持ち、学業を通しての成長と社会貢献に意欲のある学生を後押しするものです。当制度を通じて次代を担う若者たちの成長と社会貢献への意欲を後押しすることで、社会的課題の解決に寄与してまいります。



39矢野基金への協力

元阪神タイガース監督の矢野燿大氏(当社取締役)による「39(サンキュー)矢野基金」活動に賛同し、売上の一部が筋ジストロフィー症患者の方や児童養護施設の子供たちへの支援金となる「応援自動販売機」を設置しています。2015年に設置した「応援自動販売機」は京都での設置第一号となりました。



本社・工場に設置の応援自動販売機

京都子ども探求博

イオンモール桂川(8月16日)と京都府大山崎町のアート&テクノロジー・ヴィレッジ京都(9月16日)で開催されたイベント「京都子ども探求博」(京都府と京都産業21主催)に企業ブースを出展しました。本イベントは、小・中学生たちがものづくりや京都企業の技術に触れ、好奇心や探求心を育む貴重な機会を提供するものです。

身近なスマートフォンと当社技術との関わりや、超撥水技術などの紹介を行い、アンケートを通してたくさんのユニークなアイデアが寄せられました。当社の地域貢献活動として有意義なものとなりました。



超撥水技術の紹介の様子

Topics 「トワッピー」ご紹介！

「トワッピー」は、長期ビジョン「TOWA ビジョン2032」達成に向けたメッセージを広く内外に発信するため制作したキャラクターです。あわせてビジュアルコンセプトメッセージ「Happy Tech Happy World」を制定しています。長期ビジョン実現に向けて、採用などの人材確保や、BtoCを視野に入れた新たな事業展開を見据えて、知名度の高い会社を目指してまいります。



なまえ	トワッピー
なまへの由来	TOWA 発で世界にハッピーを届けます
住んでいるところ	京都
身長	100.1cm
誕生日	4月17日(TOWA創立記念日)
使命	半導体を核として、世界中の人々に幸せを届ける
夢	Happy Tech を次々と生み出し幸せを実感できる世界に貢献すること
好きな言葉	チャレンジ！



TOWA グループのコーポレートガバナンス

高度なコーポレートガバナンスを実現するために

当社は、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレートガバナンス体制の充実を図っています。

当社は、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの一層の強化と実践に努めています。

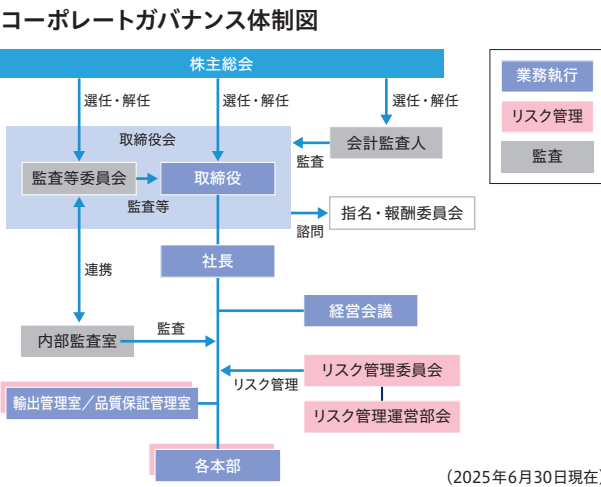
- 1. 当社グループの行動が法と社会倫理に基づいていること
- 2. 経営の透明性、客観性を確保し維持すること
- 3. 環境の変化に迅速に対応できる組織・体制を構築すること
- 4. 株主の権利の保護や平等性の確保など株主重視の公正な経営を徹底していくこと
- 5. ステークホルダーとの円滑な関係の構築を通じて企業価値や雇用を創造すること

コーポレートガバナンスシステム

当社の主な取り組み内容は以下のとおりです。

取締役会の機能強化について

当社は取締役会の機能強化とコーポレートガバナンスの一層の充実を図るとともに、迅速な意思決定と業務執行により経営の効率性を高める目的から、監査等委員設置会社の制度を採用しています。なお、社外取締役は4名(男性2名、女性2名)で、独立社外取締役の取締役会に占める比率は3分の1以上となっています。



取締役会の概要

取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)7名(うち1名は独立社外取締役)と監査等委員4名(うち3名は独立社外取締役)で構成されており、取締役社長 三浦宗男を議長とし、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しています。

取締役会の概要と活動状況

構成	取締役11名(うち独立社外取締役4名)
2024年度開催実績	17回
主な決議事項	株主総会に関する事項、決算に関する事項、役員報酬に関する事項、予算・事業計画に関する事項、人事・組織に関する事項、資金に関する事項、子会社に関する事項、サステナビリティに関する事項、重要な社内規程の改廃に関する事項等
主な報告事項	取締役会実効性評価に関する報告、業務執行状況に関する報告、月次業績に関する報告、監査に関する報告、政策保有株式に関する報告等

取締役会の実効性の状況としましては、取締役会の議決権を有する監査等委員が監査を行い、取締役会の現状について正しく理解し、より実効性の高い運営をしています。取締役会は毎年1回、取締役全員を対象としたアンケート(自己評価)を実施し、取締役会の実効性の分析・評価を行っています。

結果につきましては、取締役会は、社外役員の意見・質問も含め、各自が自由な意見が述べられ、充実した議論が行われていること、また、取締役会の開催頻度や時間、審議項目の数や内容等の運営についても適切・十分になされているとの評価を受けており、実効性が確保されていることを確認しています。また、アンケート結果や意見について取締役会で議論を行っており、取締役会のさらなる実効性の向上に向けて取り組んでいます。

取締役会の構成につきましては、重要な経営判断と業務執行の監督が適切なバランスとなるよう、取締役に必要な経験・知見・能力を特定した上で、その構成や多様性等を考慮しています。取締役の主たる経験分野・専門性を記載したスキルマトリックスにつきましては、56ページの「役員一覧」をご参照ください。

任意の委員会について

取締役の人事および報酬制度における審議プロセスの公正性、透明性および客観性を高め、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会を設置しています。当委員会は、独立社外取締役4名と、代表取締役会長1名、取締役社長執行役員1名および取締役常務執行役員管理本部長1名の計7名で構成されており、議長は独立社外取締役が務めています。

指名・報酬委員会

議長	取締役監査等委員(社外)	和氣 大輔	2024年度開催実績
委員	代表取締役会長 取締役社長執行役員営業本部長 取締役常務執行役員管理本部長 取締役(社外) 取締役監査等委員(社外) 取締役監査等委員(社外)	岡田 博和 三浦 宗男 柴原 信隆 矢野 輝弘 後藤 美穂 田中 素子	3回

監査等委員会について

監査等委員会は、取締役 服部広志の1名と社外取締役 和氣大輔、後藤美穂、田中素子の3名で構成されています。監査等委員会における具体的な検討内容としては、監査方針・監査計画及び業務分担、監査報告の作成、会計監査人に関する評価、監査等委員である取締役以外の取締役の人事・報酬についての意見形成、常勤監査等委員の職務執行状況報告等です。2024年度、監査等委員会は17回開催しています。

リスクマネジメント

社内のリスク管理の最高機関として、社長を議長とする「リスク管理委員会」を設け、定期的に対処すべきリスクの抽出や評価を実施しています。当委員会の下には複数のリスク管理分科会が設置されており、テーマごとに内部統制、輸出管理、品質保証等におけるリスクを毎月ウォッチしています。これらの分科会の活動状況は4半期ごとに取締役会で報告され社外取締役も内容を確認しています。

TOWAグループのコーポレートガバナンス

事業等のリスクについて

当社グループは、半導体や医療機器など現代社会に不可欠な最終製品を支える重要な役割を担い、また半導体事業を中心にグローバルで事業を展開していることから多様なリスクに晒されています。投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項として下表の項目を抽出しています。これらのリスクの説明や対応は、有価証券報告書「事業等のリスク」に詳細を掲載していますのでご参照ください。なお、これらのリスクは当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、また当社グループに関するリスクを網羅したものではありません。

 <https://www.towajapan.co.jp/jp/wp-content/uploads/sites/2/2024/10/2025account.pdf>

リスク項目	
(1)販売に関するリスク	(4)人財の採用や育成に関するリスク
① 経済及び半導体市場の動向によるリスク	(5)財務に関するリスク
② 価格競争に関するリスク	① 為替リスク
③ 販売先や地域の集中に関するリスク	② 有利子負債に関するリスク
(2)生産に関するリスク	③ 固定資産の減損処理に関するリスク
① 海外展開に伴うリスク	(6)情報セキュリティに関するリスク
② 自然災害等のリスク	(7)気候変動に関するリスク
③ 原材料等の調達に関するリスク	
(3)開発に関するリスク	
① 新製品の開発リスク	
② 知的財産に関するリスク	

コーポレートガバナンス強化・企業価値向上に向けた取り組み

コンプライアンスの取り組み

内部通報制度	「腐敗防止方針」につきましては、下記のウェブサイトをご参照ください。
社員相談窓口として総務部が専用メールアドレスを設けており、社員は直接通報や相談ができる仕組みを整えています。女性社員専用のメールアドレスも設けており、担当の女性社員に直接届くようになっています(電子メール以外の面会等による方法も可能です)。調査委員会が調査を行い、必要に応じて社外の専門家等にも相談いたします。なお、公益通報者が不利益を被らないよう社内規程で定め配慮しています。	 https://www.towajapan.co.jp/jp/company/anticorruption/
腐敗行為の防止	社内教育
当社グループは、「腐敗防止方針」に基づき、贈収賄、横領、利益供与の強要、不正入札等の、自己または第三者の職務上の権力や地位の濫用といった腐敗行為、また、それに加担する行為である司法妨害、資金洗浄等の防止の徹底に努めています。	法令や社会規範を遵守して事業活動および会社生活を営むうえで必要となる知識を、主にeラーニングを通じて社員に徹底しています。階層別で受講するWeb通信教育講座でもCSR・コンプライアンス関連の講座を設けています。定期的実施することにより社員の知識・意識の定着を図っています。
	〈実施している教育の例〉 コンプライアンス教育、輸出管理教育、ハラスメント研修、メンタルヘルス教育、情報セキュリティ教育、環境教育

コーポレートガバナンス強化への主な実施項目

取締役会の機能強化に向けて	知的財産管理
取締役会の機能強化と多様性を高める目的から2022年6月より、女性役員を1名増員し2名といたしました。2025年7月現在、女性役員比率は18%です。	「知的財産方針」に基づき、国内外知的財産の更なる強化や、他社権利侵害等のリスク対策に取り組んでいます。発明・創作の活性化を図るとともに、全社知財・統制管理の強化のために活動範囲を全社グループに拡大し、適切な知財管理体制の構築を進めてまいります。
有価証券報告書へのサステナビリティ情報開示推進	「知的財産方針」につきましては、下記のウェブサイトをご参照ください。
企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正の内容に基づき、サステナビリティ情報の開示を推進しています。サステナビリティに関する体制の整備や取り組みを進め、情報開示の充実化を図ってまいります。	 https://www.towajapan.co.jp/jp/company/ip/

政策保有株式の縮減について

当社は、持続的な成長と中長期的な成長を図るため、業務提携、資金調達、取引拡大など経営戦略の一環として、必要と判断する企業の株式を保有することがあります。保有する株式については、保有目的が適切か、保有にともなう便益やリスクが資本コストに見合っているか等を定期的に検証するとともに、検証結果を踏まえ、取締役会で保有継続の可否等について判断いたします。保有する意義の乏しいと判断される銘柄については、市場動向や考慮すべき事情に配慮しつつ売却を行います。

2025年3月期については1銘柄を売却しました。政策保有株式残高については、2025年3月末の時価で換算すると、2025年3月末連結純資産の7.2%になりました。なお、コーポレートガバナンス・コードが導入された2015年6月以降、7銘柄を売却しています。引き続き、保有する意義の乏しいと判断される銘柄については、売却等について検討を進めてまいります。

議決権の行使については、投資先企業の中長期的な企業価値の向上に資するものであるかどうか、また当社への影響などを総合的に判断して適切に行使用いたします。

その他、詳細につきましては下記コーポレートガバナンスのウェブサイトをご参照ください。

 <https://www.towajapan.co.jp/jp/company/governance/>

IR・SR活動について

当社は、アナリスト、機関投資家、個人投資家等のステークホルダーの皆様との対話を積極的に実施し、当社の考えや状況を説明するとともに、いただいたご意見は経営陣にて共有し、企業価値向上に取り組んでいます。

IR・SR活動内容	2024年3月期実績	2025年3月期実績
決算説明会・記者会見(CEO対応)	4回	4回
機関投資家・アナリストとの個別面談	約330回	約400回
機関投資家向けカンファレンス参加	3回	11回

このほかにも、各種展示会にて機関投資家やアナリスト向けにTOWAの製品や技術の紹介を実施。

役員一覧

取締役



代表取締役会長
岡田 博和
(最高経営責任者)



取締役社長執行役員
三浦 宗男
営業本部長



取締役専務執行役員
石田 耕一
コア技術事業本部長



取締役常務執行役員
柴原 信隆
管理本部長



取締役上席執行役員
西村 一洋
生産本部長



取締役執行役員
中西 和彦
経営企画本部長 兼 秘書室長 兼
INNOMS 推進室長



取締役(社外)
矢野 輝弘



取締役常勤監査等委員
服部 広志



取締役監査等委員(社外)
和氣 大輔
和氣公認会計士事務所所長
シライ電子工業株式会社
社外取締役監査等委員



取締役監査等委員(社外)
後藤 美穂
後藤総合法律事務所弁護士



取締役監査等委員(社外)
田中 素子
田中公認会計士事務所所長
株式会社ワコールホールディングス
社外監査役

執行役員

常務執行役員
鈕 方舜
東和半導体設備(上海)有限公司 董事長

常務執行役員
韓 相倫
TOWA 韓国株式会社 代表理事

執行役員
笹田 秀典
TOWATEC 株式会社 代表取締役社長

執行役員
寺内 利浩
株式会社バンディック 代表取締役社長

執行役員
高田 直毅
開発本部長

スキルマトリックス

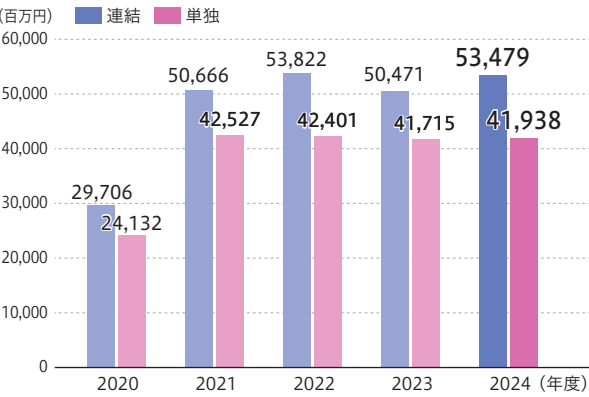
	地位・役職	社外	独立	指名報酬委員会	企業経営	人財開発	生産技術開発	海外駐在経験	営業マーケティング	会計	法務コンプライアンス
岡田 博和	代表取締役会長			○	●		●	●	●		
三浦 宗男	取締役社長執行役員			○				●	●		
石田 耕一	取締役専務執行役員						●		●		
柴原 信隆	取締役常務執行役員			○	●	●		●			●
西村 一洋	取締役上席執行役員				●		●	●			
中西 和彦	取締役執行役員				●					●	
矢野 輝弘	取締役	○	○	○		●					
服部 広志	取締役常勤監査等委員									●	
和氣 大輔	取締役監査等委員	○	○	◎						●	
後藤 美穂	取締役監査等委員	○	○	○							●
田中 素子	取締役監査等委員	○	○	○						●	

◎は委員長

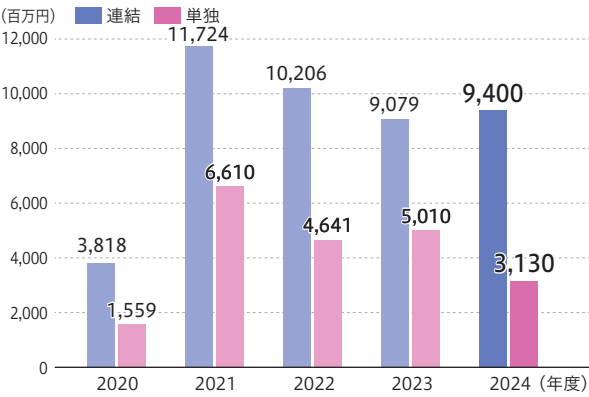
財務・非財務ハイライト

財務ハイライト

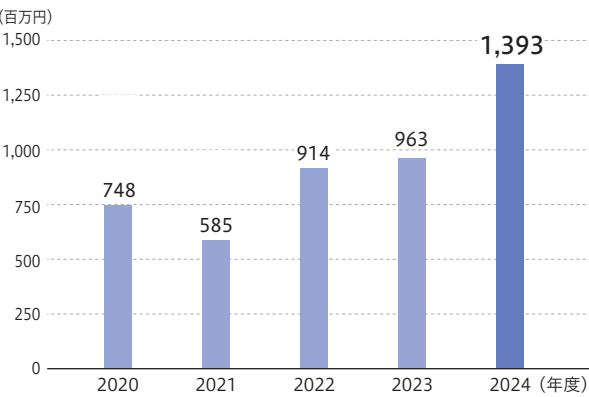
売上高



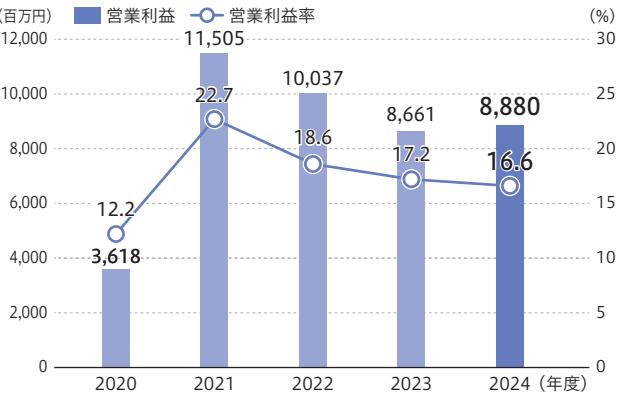
経常利益



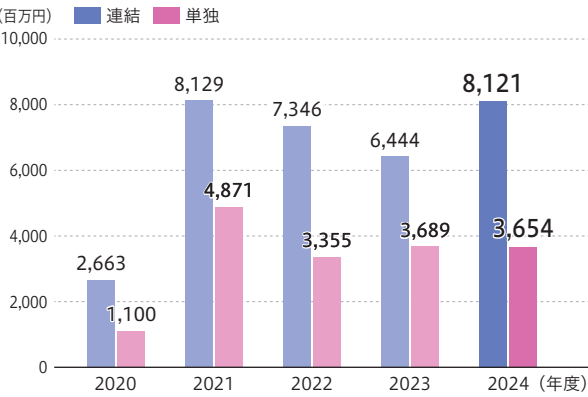
研究開発費(連結)



営業利益／営業利益率(連結)

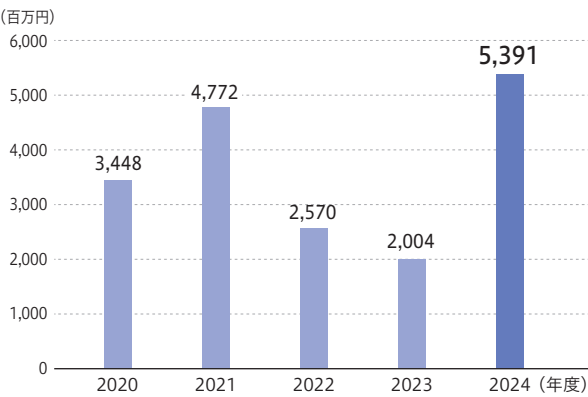


当期純利益



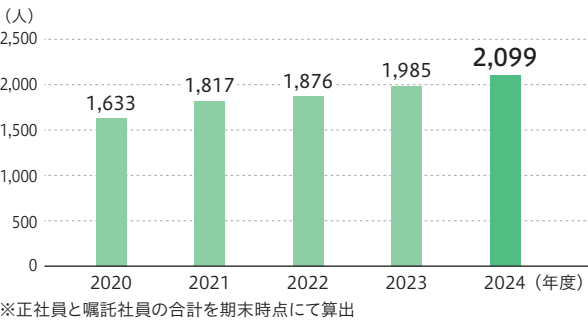
※連結については、親会社株主に帰属する当期純利益を記載しております。

設備投資(連結)

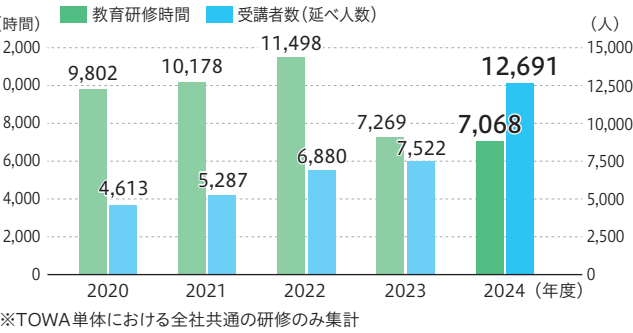


非財務ハイライト

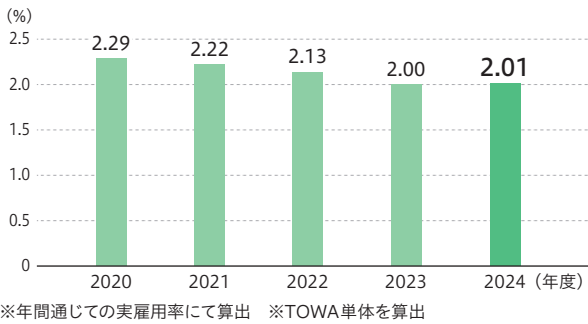
連結従業員数



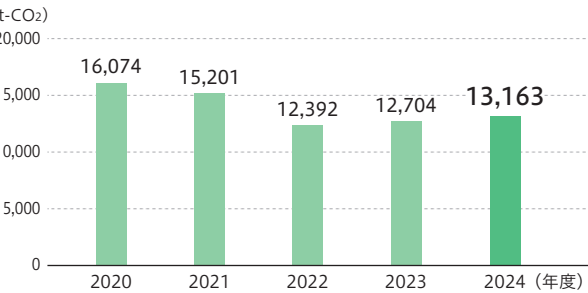
教育研修時間と受講者数



障がい者雇用率

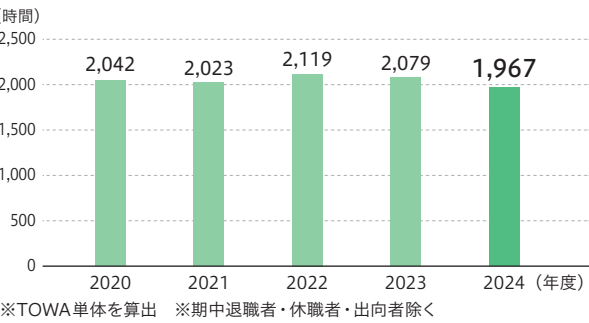


CO₂排出量

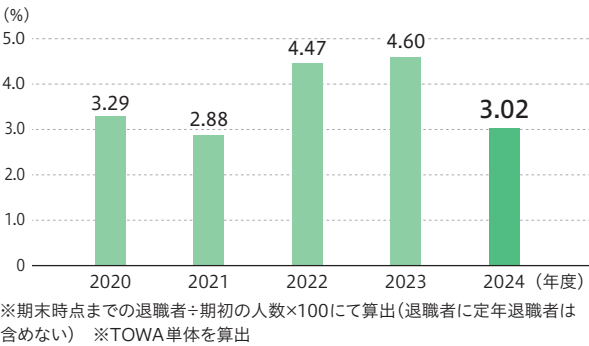


国内のグループ会社を含む5つの拠点と、海外グループ会社の6つの生産拠点の合計。CO₂への換算係数は、国内は環境省の「電気事業者別排出係数一覧」、海外はIEA発行のEmissions Factorsを使用。燃料は、国内ガス会社の公表値、および環境省の「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」を使用。

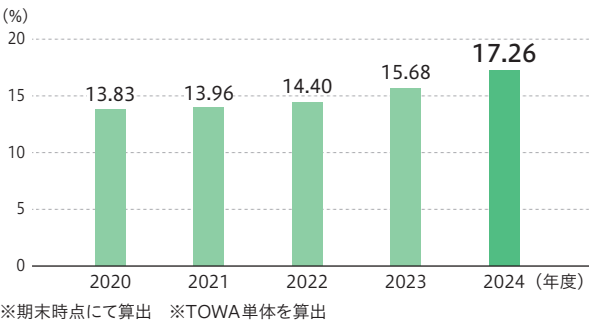
一人当たりの総労働時間数



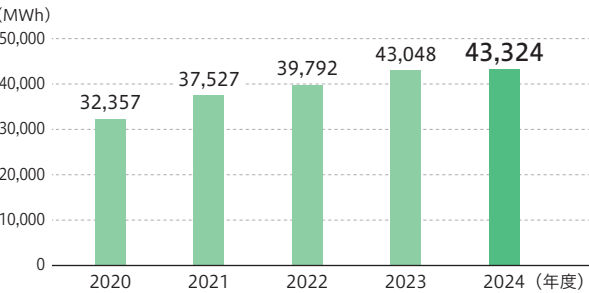
正社員の離職率



女性従業員割合



電力使用量



国内のグループ会社を含む5つの拠点と、海外グループ会社の6つの生産拠点の合計。

連結貸借対照表

(単位：千円)		
資産	2024年3月期	2025年3月期
流動資産		
現金及び預金	20,830,999	21,338,921
受取手形	86,464	58,972
電子記録債権	345,054	351,247
売掛金	15,049,199	11,332,248
リース債権及びリース投資資産	－	19,965
商品及び製品	4,110,721	3,828,829
仕掛品	10,041,146	10,223,352
原材料及び貯蔵品	1,699,212	1,795,319
その他	1,550,660	1,709,806
貸倒引当金	△2,363	△6,364
流動資産合計	53,711,096	50,652,299
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	22,106,434	22,949,252
減価償却累計額	△13,065,298	△13,670,130
建物及び構築物(純額)	9,041,135	9,279,121
機械装置及び運搬具	17,554,193	18,094,025
減価償却累計額	△11,954,563	△12,434,302
機械装置及び運搬具(純額)	5,599,630	5,659,723
土地	5,289,066	6,566,490
リース資産	1,594,823	1,685,684
減価償却累計額	△440,008	△509,906
リース資産(純額)	1,154,815	1,175,777
建設仮勘定	232,675	829,705
その他	4,852,823	5,248,194
減価償却累計額	△4,002,437	△4,258,128
その他(純額)	850,385	990,066
有形固定資産合計	22,167,709	24,500,885
無形固定資産		
その他	1,329,271	1,421,284
無形固定資産合計	1,329,271	1,421,284
投資その他の資産		
投資有価証券	9,244,703	4,446,381
繰延税金資産	445,334	517,376
退職給付に係る資産	641,147	678,782
その他	322,569	1,011,477
投資その他の資産合計	10,653,756	6,654,017
固定資産合計	34,150,736	32,576,186
資産合計	87,861,833	83,228,486

(単位：千円)		
負債及び純資産	2024年3月期	2025年3月期
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,834,249	2,551,525
電子記録債務	36,252	28,887
短期借入金	9,400,000	7,000,000
1年内返済予定の長期借入金	1,560,000	1,120,000
リース債務	149,506	166,833
未払法人税等	1,827,856	1,222,764
前受金	2,598,098	1,819,014
賞与引当金	986,299	1,168,008
役員賞与引当金	98,443	117,231
製品保証引当金	307,882	313,722
その他	2,399,211	2,501,956
流動負債合計	23,197,801	18,009,944
固定負債		
長期借入金	2,490,000	1,370,000
リース債務	419,819	407,950
繰延税金負債	2,330,034	957,017
退職給付に係る負債	933,297	1,014,238
株式給付引当金	40,497	82,967
その他	14,479	－
固定負債合計	6,228,128	3,832,173
負債合計	29,425,930	21,842,118
株主資本		
資本金	8,955,671	8,969,261
資本剰余金	450,981	464,571
利益剰余金	38,359,732	45,479,594
自己株式	△115,191	△115,241
株主資本合計	47,651,194	54,798,186
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	6,013,298	2,817,381
為替換算調整勘定	4,642,014	3,716,815
退職給付に係る調整累計額	129,394	53,984
その他の包括利益累計額合計	10,784,708	6,588,181
純資産合計	58,435,903	61,386,368
負債純資産合計	87,861,833	83,228,486

連結損益計算書及び
連結包括利益計算書

(単位：千円)		
連結損益計算書	2024年3月期	2025年3月期
売上高	50,471,799	53,479,205
売上原価	32,273,620	33,572,197
売上総利益	18,198,179	19,907,008
販売費及び一般管理費	9,536,350	11,026,604
営業利益	8,661,829	8,880,404
営業外収益		
受取利息	145,619	191,313
受取配当金	282,068	131,849
固定資産賃貸料	57,982	71,243
雑収入	170,083	307,345
営業外収益合計	655,754	701,751
営業外費用		
支払利息	71,787	91,336
貸与資産減価償却費	30,397	33,083
為替差損	120,986	31,466
雑損失	14,677	25,884
営業外費用合計	237,849	181,771
経常利益	9,079,734	9,400,384
特別利益		
固定資産売却益	35,135	6,559
固定資産受贈益	23,200	－
投資有価証券売却益	－	1,306,284
受取損害賠償金	－	524,175
特別利益合計	58,335	1,837,020
特別損失		
固定資産売却損	－	2,734
固定資産除却損	10,209	14,292
投資有価証券評価損	12,786	12,056
特別損失合計	22,995	29,083
税金等調整前当期純利益	9,115,073	11,208,320
法人税、住民税及び 事業税	2,942,089	3,149,194
法人税等調整額	△271,208	△61,924
法人税等合計	2,670,880	3,087,270
当期純利益	6,444,193	8,121,050
親会社株主に帰属する 当期純利益	6,444,193	8,121,050

(単位：千円)		
連結包括利益計算書	2024年3月期	2025年3月期
当期純利益	6,444,193	8,121,050
その他の包括利益		
その他有価証券 評価差額金	3,700,708	△3,195,917
為替換算調整勘定	2,071,376	△925,199
退職給付に係る調整額	109,390	△75,410
その他の包括利益合計	5,881,475	△4,196,527
包括利益	12,325,668	3,924,523
(内訳)		
親会社株主に係る 包括利益	12,325,668	3,924,523

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)		
連結キャッシュ・フロー計算書	2024年3月期	2025年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	9,115,073	11,208,320
減価償却費	2,540,701	2,673,130
のれん償却額	146,567	149,445
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△641	4,156
賞与引当金の増減額(△は減少)	△17,175	186,197
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,688	19,680
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	6,952	△77,837
株式給付引当金の増減額 (△は減少)	40,497	44,209
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△9,671	7,903
受取利息及び受取配当金	△427,687	△323,162
支払利息	71,787	91,336
為替差損益(△は益)	66,833	△21,873
投資有価証券売却損益(△は益)	－	△1,306,284
売上債権の増減額(△は増加)	△1,476,948	2,844,772
棚卸資産の増減額(△は増加)	96,607	21,205
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△43,896	△475,440
仕入債務の増減額(△は減少)	1,193,242	△1,300,121
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	348,150	△148,798
その他	△339,832	175,611
小計	11,308,874	13,772,451
利息及び配当金の受取額	258,150	325,446
利息の支払額	△73,066	△92,933
法人税等の支払額	△1,906,869	△3,646,478
法人税等の還付額	78,790	14,319
営業活動による キャッシュ・フロー	9,665,880	10,372,805
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△505,352	△1,772,258
定期預金の払戻による収入	322,857	1,122,975
投資有価証券の売却による収入	－	1,540,447
その他の投資に係る支出	△4,589	△513,930
有形及び無形固定資産の 取得による支出	△1,668,564	△5,044,564
有形及び無形固定資産の 売却による収入	35,612	11,454
事業譲受による支出	△933,600	－
その他	△20,128	△102,342
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,773,764	△4,758,217
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	－	△2,400,000
長期借入れによる収入	100,000	－
長期借入金の返済による支出	△1,930,000	△1,560,000
自己株式の取得による支出	△101,754	△2,111
配当金の支払額	△1,000,785	△1,001,188
連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出	△435,922	－
その他	△155,902	△162,963
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,524,364	△5,126,263
現金及び現金同等物に 係る換算差額	719,024	△615,211
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	4,086,775	△126,886
現金及び現金同等物の期首残高	16,430,497	20,517,272
現金及び現金同等物の期末残高	20,517,272	20,390,386

グローバルネットワーク

TOWA株式会社

- ①本社・工場

②京都東事業所

③九州事業所
- ④東京営業所

⑤長野営業所



①本社・工場



②京都東事業所



③九州事業所

- 生産拠点
- 販売拠点
- サービス拠点
- トレーニングセンター
- ラボラトリ



⑥バンディック

⑥株式会社バンディック

TOWATEC株式会社

- ①本社

③九州サービス

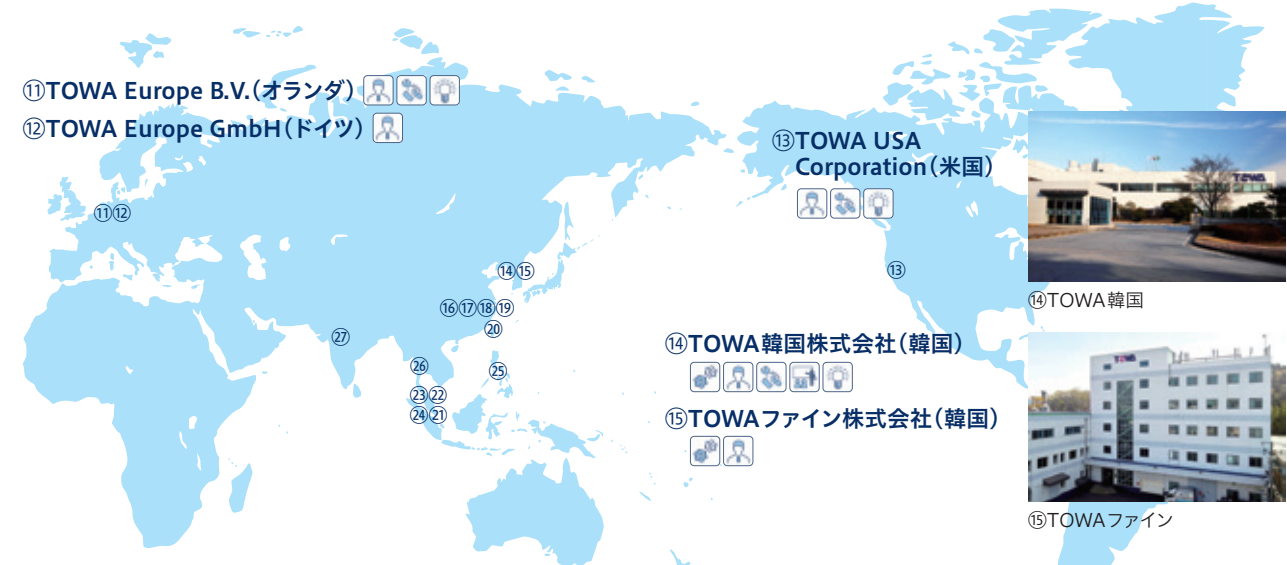
⑦東北サービス

TOWAレーザーフロント株式会社

- ⑧本社・工場

⑨中部営業所

⑩関西営業所



⑩TOWA半導体設備(蘇州)



⑩東和半導体設備(南通)



②TOWAM



③TOWA TOOL

- ⑩TOWA半導体設備(蘇州)有限公司(中国)

⑩東和半導体設備(上海)有限公司(中国)

⑩東和半導体設備(南通)有限公司(中国)

⑩東和半導体設備研究開発(蘇州)有限公司(中国)

⑩台湾東和半導体設備股份有限公司(台湾)

⑩TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd.(シンガポール)

⑩TOWAM Sdn. Bhd.(マレーシア)

⑩TOWA TOOL SDN. BHD.(マレーシア)

⑩TOWA MALAYSIA SALES & SERVICES SDN. BHD.(マレーシア)

⑩TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.(フィリピン)

⑩TOWA THAI COMPANY LIMITED(タイ)

⑩TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED(インド)

会社概要 (2025年3月31日現在)

会社情報

商号	TOWA 株式会社 (英文名 TOWA CORPORATION)
設立	1979年4月17日
資本金	8,969,261,572円
本社所在地	京都市南区上鳥羽上調子町5番地 ☎(075)692-0250(代表)
従業員数	681名(単体) 2,099名(連結)
ホームページ	https://www.towajapan.co.jp
上場取引所	東京証券取引所プライム市場

TOWAグループ

国内
TOWA 株式会社 本社・工場 京都東事業所 九州事業所 株式会社バンディック TOWATEC 株式会社 TOWA レーザーフロント株式会社

海外
TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd.(シンガポール) TOWAM Sdn. Bhd.(マレーシア) TOWA TOOL SDN. BHD.(マレーシア) TOWA MALAYSIA SALES & SERVICES SDN. BHD.(マレーシア)※ TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.(フィリピン) TOWA THAI COMPANY LIMITED(タイ) TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED(インド)※ TOWA USA Corporation(米国) TOWA Europe B.V.(オランダ) TOWA Europe GmbH(ドイツ) TOWA 半導体設備(蘇州)有限公司(中国) 東和半導体設備(上海)有限公司(中国) 東和半導体設備(南通)有限公司(中国) 東和半導体設備研究開発(蘇州)有限公司(中国) 台湾東和半導体設備股份有限公司(台湾) TOWA 韓国株式会社(韓国) TOWA ファイン株式会社(韓国) ※2025年4月に設立

株式情報

発行可能株式総数	240,000,000株
発行済株式の総数	75,140,556株
株主数	62,162名
事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日までの1年
定時株主総会	毎年6月
基準日	株主総会権利行使および期末配当 3月31日 中間配当 9月30日
単元株式数	100株
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部
郵便物の郵送先及び 電話お問い合わせ先	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社証券代行部 ☎0120-288-324(フリーダイヤル)
未払い配当金のお支払	みずほ信託銀行 本店および全国各支店 みずほ銀行 本店および全国各支店
公告方法	電子公告の方法により行います。但し、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載 URL https://www.towajapan.co.jp

大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	5,753	7.66
株式会社ケイビー恒産	5,700	7.59
株式会社エヌレガロ	3,780	5.03
株式会社京都銀行	2,099	2.80
株式会社日本カストディ銀行	1,798	2.39
JPモルガン証券株式会社	1,623	2.16
濱田 英之	1,286	1.71
楽天証券株式会社	1,127	1.50
TOWA 社員持株会	934	1.24
JP MORGAN CHASE BANK 385781	849	1.13

(注1) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ銀行の持株数は信託業務に係るものです。
(注2) 持株比率は、自己株式(43,275株)を控除して計算しております。
(注3) 2024年8月29日開催の取締役会決議により、2024年10月1日付で株式分割(1株につき3株に分割)に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は、160,000,000株増加しております。
(注4) 2024年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、上記株式数については、当該株式分割後の株式数を記載しております。

所有者別株式数分布

